

2024年10月13日



华鑫证券
CHINA FORTUNE SECURITIES

联发科天玑 9400 横空出世，AMD 最强 AI 芯片闪耀登场

—电子行业周报

推荐(维持)

投资要点

分析师：毛正 S1050521120001

maozheng@cfsc.com.cn

分析师：吕卓阳 S1050523060001

lvzy@cfsc.com.cn

行业相对表现

表现	1M	3M	12M
电子(申万)	27.6	10.8	3.4
沪深300	22.5	11.9	5.0

市场表现



资料来源：Wind，华鑫证券研究

相关研究

- 《电子行业周报：纯血鸿蒙即将公测，特斯拉即将发布 Robotaxi》2024-09-30
- 《电子行业周报：华为有望推出鸿蒙版 PC，高通向英特尔发出收购要约》2024-09-23
- 《电子行业周报：苹果 iPhone16 和 华为三折叠手机发布，上海微电子极紫外相关专利公布》2024-09-17

上周回顾

10月08日-10月11日当周，申万一级行业均处于下跌态势。其中电子行业下跌11.65%，位列第22位。估值前三的行业为计算机、国防军工、综合，电子行业市盈率为49.76。

电子行业细分板块比较，10月08日-10月11日当周，电子行业细分板块均处于下跌态势。其中，分立器件、数字芯片设计、集成电路封测跌幅最小。估值方面，半导体材料、数字芯片设计、模拟芯片设计估值水平位列前三，分立器件、LED估值排名本周第四、五位。

采用台积电第二代 3nm 工艺打造的联发科天玑 9400 旗舰芯片横空出世

联发科近日推出新一代高智能、高性能、高能效、低能耗的旗舰 5G 智能体 AI 芯片天玑 9400。天玑 9400 采用台积电第二代 3nm 工艺打造，拥有 291 亿晶体管，较前一代增加 28%，但功耗却同比大降 40%。根据 IDC 预测，预计 2024 年全球生成式人工智能手机出货量将同比增长 363.6%，达到 2.342 亿部，出货总量占 2024 年整个智能手机市场的 19%，预计 AI 手机的出货量将在 2028 年达到 9.12 亿部，2024-2028 年的复合年增长率 (CAGR) 为 78.4%。NPU 方面，天玑 9400 集成了性能更强、能效更高的第八代 AI 处理器 NPU 890，其端侧多模态 AI 运算性能高达 50 Tokens/s。与天玑 9300 相比，其大语言模型 (LLM) 的提示词处理性能实现了 80% 的提升，Stable Diffusion 的执行性能提升了 2 倍，AI 模型文本长度提升达 8 倍，但功耗同比大幅下降了 35%。其率先支持时域张量 (Temporati Tensor) 硬件指令加速、率先支持端侧高画质高画质 DiT (Diffusion Transformer) 技术、率先支持端侧混合专家 (MoE) 模型。CPU 方面，联发科在天玑 9400 上采用了 1 个 Cortex-X925 (3.62GHz) 超大核、3 个 Cortex-X4 (3.3GHz) 超大核和 4 个 Cortex-A720 (2.4GHz) 大核的新一代“全大核”设计。在 5G 性能方面，其新一代 3GPP R17 5G 调制解调器，支持四载波聚合 (4CC-CA)，Sub-6GHz 网络下行传输速率可达 7Gbps，支持 5G/4G

多制式双卡双通。能把 16 种场景辨别准确率提升 99.5%，还可以将功耗降低 18%的同时，将网速提升 30%。

我们认为，AI 手机元年已经开启，伴随手机 SOC 和存储的进一步升级迭代，AI 手机端侧功能将进一步丰富，早期端侧模型能力可能覆盖场景有限，但随着核心硬件和端侧模型参数的提升，用户或将快速改变与终端的交互模式，AI 时代终将全面开启。

■ AMD 最强大模型芯片面世，谷歌、OpenAI、微软、Meta 等核心生态伙伴现场支持

AMD 旗舰 AI 芯片 AMD Instinct MI325X GPU 首次启用 HBM3E 高带宽内存，AI 峰值算力达到 21PFLOPS，并与去年发布的、同样采用 HBM3E 的英伟达 H200 GPU 用数据掰手腕：内存容量是 H200 的 1.8 倍，内存带宽、FP16 和 FP8 峰值理论算力都是 H200 的 1.3 倍。与 NVIDIA H200 HGX 相比，新平台在内存容量（1.8 倍）、内存带宽（1.3 倍）和 FP16 和 FP8 Flops（1.3 倍）上的表现都领先于前者，单 GPU 还是在 8 GPU 的 Meta Llama-2 训练场景，AMD Instinct MI325X 平台的表现都不逊色于前者。在架构表现大幅提升的同时，新一代的 Instinct GPU 还使用了先进的 3nm 工艺技术构建，搭载高达 288 GB 的 HBM3E 内存，并支持 FP4 和 FP6 AI 数据类型，进一步提升了整体的性能表现。AMD 还披露了最新的 AI 芯片路线图，采用 CDNA 4 架构的 MI350 系列明年上市，其中 MI355X 的 AI 峰值算力达到 74PFLOPS，MI400 系列将采用更先进的 CDNA 架构。

■ 台积电 2nm 即将公布，英特尔、三星加入 2nm 技术竞赛

在今年 12 月于旧金山举行的国际电子设备会议（IEDM）上，英特尔试图展示重回芯片制造和代工领域的前沿。台积电的研究人员表示，公司将在本届的 IEDM 公布专为 AI、移动和高性能计算而设计的 N2 制造工艺，在 IEDM 会议上，台积电的研究人员预计将报告称，与 2022 年推出的 N3（标称 3nm）工艺相比，N2 的速度可提高 15% 或功耗降低 30%，芯片密度也可提高 15% 或更高。台积电的 G. Yeap 等人撰写的论文 2.1 2nm 平台技术，具有节能纳米片晶体管和互连，与 3DIC 共同优化，适用于 AI、HPC 和移动 SoC 应用，还将展示具有世界纪录密度为每平方毫米 38Mbits 的 SRAM 宏。英特尔、三星和台积电正处于在其 2 纳米节点中实施背面供电技术的竞争前沿，旨在增强其在 AI 芯片市场的竞争力。这项创新技术有望通过将供电网络重新定位到硅片背面来提高芯片效率，此举旨在简化电源效率、减少干扰并提高整体性能。英特尔今年在商业化方面处于领先地位，三星电子和台积电紧随其后，准备在 2025 年进行大规模生产，业界对背面供电的变革性影响充满期待。

建议关注：

苹果产业链：立讯精密、领益智造、鹏鼎控股、歌尔股份、瑞声科技、舜宇光学、高伟电子、赛腾股份、中石科技、思泉新材等。

■ 风险提示

半导体制裁加码，晶圆厂扩产不及预期，研发进展不及预期，地缘政治不稳定，推荐公司业绩不及预期等风险。

重点关注公司及盈利预测

公司代码	名称	2024-10-11		EPS			PE			投资评级
		股价	2023	2024E	2025E	2023	2024E	2025E		
002241.SZ	歌尔股份	22.13	0.32	0.75	1.01	69.16	29.51	21.91	买入	
002475.SZ	立讯精密	42.20	1.53	1.88	2.26	27.58	22.45	18.67	增持	
002600.SZ	领益智造	7.23	1.17	0.36	0.43	6.18	20.08	16.81	买入	
002938.SZ	鹏鼎控股	35.18	1.42	1.72	2.16	24.77	20.45	16.29	买入	
300684.SZ	中石科技	17.67	0.25	0.53	0.77	70.68	33.34	22.95	买入	
301489.SZ	思泉新材	66.97	1.44	1.89	2.47	46.51	35.43	27.11	增持	
603283.SH	赛腾股份	66.51	3.43	4.08	4.79	19.39	16.30	13.89	买入	
2018.HK	瑞声科技	31.4	0.63	1.82	46.06	20.71	1.38	15.67	未评级	
2382.HK	舜宇光学	55.25	1.01	2.59	49.86	24.04	2.10	19.44	未评级	
1415.HK	高伟电子	23.55	0.06	0.19	55.53	27.32	0.11	16.30	未评级	

资料来源：Wind，华鑫证券研究（注：“未评级”盈利预测取自万得一致预期）

正文目录

1、 股票组合及其变化.....	6
1.1、 本周重点推荐及推荐组	6
1.2、 海外龙头一览	7
2、 周度行情分析及展望.....	9
2.1、 周涨幅排行	9
2.2、 行业重点公司估值水平和盈利预测	12
3、 行业高频数据.....	15
3.1、 台湾电子行业指数跟踪	15
3.2、 电子行业主要产品指数跟踪	17
4、 近期新股.....	21
4.1、 珂玛科技（301611.SZ）：国内先进陶瓷材料零部件领先企业.....	21
4.2、 龙图光罩（688721.SH）：国内稀缺独立半导体掩模版供应商.....	24
5、 行业动态跟踪.....	26
5.1、 半导体	26
5.2、 消费电子	28
5.3、 汽车电子	30
6、 行业重点公司公告.....	32
7、 风险提示	40

图表目录

图表 1：重点关注公司及盈利预测	7
图表 2：海外龙头估值水平及周涨幅	7
图表 3：费城半导体指数近两周走势	8
图表 4：费城半导体指数近两年走势	8
图表 5：10月08-10月11日行业周涨跌幅比较（%）	9
图表 6：10月11日行业市盈率（TTM）比较.....	9
图表 7：10月08日-10月11日电子细分板块周涨跌幅比较（%）	10
图表 8：10月11日电子细分板块市盈率（TTM）比较.....	10
图表 9：重点公司周涨幅前十股票	11
图表 10：行业重点关注公司估值水平及盈利预测	12
图表 11：台湾半导体行业指数近两周走势	15
图表 12：台湾半导体行业指数近两年走势	15
图表 13：台湾计算机及外围设备行业指数近两周走势	15
图表 14：台湾计算机及外围设备行业指数近两年走势	15

图表 15: 台湾电子零组件行业指数近两周走势	16
图表 16: 台湾电子零组件行业指数近两年走势	16
图表 17: 台湾光电行业指数近两周走势	16
图表 18: 台湾光电行业指数近两年走势	16
图表 19: 中国台湾 IC 各板块产值当季同比变化 (%)	16
图表 20: NAND 价格 (单位: 美元)	17
图表 21: DRAM 价格 (单位: 美元)	17
图表 22: 全球半导体销售额 (单位: 十亿美元)	17
图表 23: 全球分地区半导体销售额 (单位: 十亿美元)	17
图表 24: 面板价格 (单位: 美元/片)	18
图表 25: 国内手机月度出货量 (单位: 万部, %)	18
图表 26: 全球手机季度出货量 (单位: 百万部, %)	18
图表 27: 无线耳机月度出口量 (单位: 个, %)	19
图表 28: 无线耳机累计出口量 (单位: 个, %)	19
图表 29: 中国智能手表月度产量 (单位: 万个, %)	19
图表 30: 中国智能手表累计产量 (单位: 万个, %)	19
图表 31: 全球 PC 季度出货量 (单位: 百万台, %)	20
图表 32: 中国台机/服务器月度出货量 (单位: 万台)	20
图表 33: 中国新能源车月度销售量 (单位: 万辆, %)	20
图表 34: 中国新能源车累计销售量 (单位: 万辆, %)	20
图表 35: 珂玛科技产品矩阵	21
图表 36: 珂玛科技营业收入 (亿元)	23
图表 37: 珂玛科技归母净利润 (万元)	23
图表 38: 龙图光罩产品概况	24
图表 39: 龙图光罩主要产品营收	25
图表 40: 龙图光罩营收占比	25
图表 41: 本周重点公司公告	32

1、股票组合及其变化

1.1、本周重点推荐及推荐组

(1) 采用台积电第二代 3nm 工艺打造的联发科天玑 9400 旗舰芯片横空出世

联发科近日推出新一代高智能、高性能、高能效、低能耗的旗舰 5G 智能体 AI 芯片天玑 9400。天玑 9400 采用台积电第二代 3nm 工艺打造，拥有 291 亿晶体管，较前一代增加 28%，但功耗却同比大降 40%。根据 IDC 预测，预计 2024 年全球生成式人工智能手机出货量将同比增长 363.6%，达到 2.342 亿部，出货总量占 2024 年整个智能手机市场的 19%，预计 AI 手机的出货量将在 2028 年达到 9.12 亿部，2024-2028 年的复合年增长率 (CAGR) 为 78.4%。NPU 方面，天玑 9400 集成了性能更强、能效更高的第八代 AI 处理器 NPU 890，其端侧多模态 AI 运算性能高达 50 Tokens/s。与天玑 9300 相比，其大语言模型 (LLM) 的提示词处理性能实现了 80% 的提升，Stable Diffusion 的执行性能提升了 2 倍，AI 模型文本长度提升达 8 倍，但功耗同比大幅下降了 35%。其率先支持时域张量 (Temporal Tensor) 硬件指令加速、率先支持端侧高画质高画质 DiT (Diffusion Transformer) 技术、率先支持端侧混合专家 (MoE) 模型。CPU 方面，联发科在天玑 9400 上采用了 1 个 Cortex-X925 (3.62GHz) 超大核、3 个 Cortex-X4 (3.3GHz) 超大核和 4 个 Cortex-A720 (2.4GHz) 大核的新一代“全大核”设计。在 5G 性能方面，其新一代 3GPP R17 5G 调制解调器，支持四载波聚合 (4CC-CA)，Sub-6GHz 网络下行传输速率可达 7Gbps，支持 5G/4G 多制式双卡双通。能把 16 种场景辨别准确率提升 99.5%，还可以将功耗降低 18% 的同时，将网速提升 30%。

我们认为，AI 手机元年已经开启，伴随手机 SOC 和存储的进一步升级迭代，AI 手机端侧功能将进一步丰富，早期端侧模型能力可能覆盖场景有限，但随着核心硬件和端侧模型参数的提升，用户或将快速改变与终端的交互模式，AI 时代终将全面开启。

(2) AMD 最强大模型芯片面世，谷歌、OpenAI、微软、Meta 等核心生态伙伴现场支持

AMD 旗舰 AI 芯片 AMD Instinct MI325X GPU 首次启用 HBM3E 高带宽内存，AI 峰值算力达到 21PFLOPS，并与去年发布的、同样采用 HBM3E 的英伟达 H200 GPU 用数据掰手腕：内存容量是 H200 的 1.8 倍，内存带宽、FP16 和 FP8 峰值理论算力都是 H200 的 1.3 倍。与 NVIDIA H200 HGX 相比，新平台在内存容量 (1.8 倍)、内存带宽 (1.3 倍) 和 FP16 和 FP8 Flops (1.3 倍) 上的表现都领先于前者，单 GPU 还是在 8 GPU 的 Meta Llama-2 训练场景，AMD Instinct MI325X 平台的表现都不逊色于前者。在架构表现大幅提升的同时，新一代的 Instinct GPU 还使用了先进的 3nm 工艺技术构建，搭载高达 288 GB 的 HBM3E 内存，并支持 FP4 和 FP6 AI 数据类型，进一步提升了整体的性能表现。AMD 还披露了最新的 AI 芯片路线图，采用 CDNA 4 架构的 MI350 系列明年上市，其中 MI355X 的 AI 峰值算力达到 74PFLOPS，MI400 系列将采用更先进的 CDNA 架构。

(3) 台积电 2nm 即将公布，英特尔、三星加入 2nm 技术竞赛

在今年 12 月于旧金山举行的国际电子设备会议 (IEDM) 上，英特尔试图展示重回芯片制造和代工领域的前沿。台积电的研究人员表示，公司将在本局的 IEDM 公布专为 AI、移动和高性能计算而设计的 N2 制造工艺，在 IEDM 会议上，台积电的研究人员预计将报告称，与 2022 年推出的 N3 (标称 3nm) 工艺相比，N2 的速度可提高 15% 或功耗降低 30%，芯片密度也可提高 15% 或更高。台积电的 G. Yeap 等人撰写的论文 2.1 2nm 平台技术，具有节能纳米片晶体管和互连，与 3DIC 共同优化，适用于 AI、HPC 和移动 SoC 应用，

还将展示具有世界纪录密度为每平方毫米 38Mbits 的 SRAM 宏。英特尔、三星和台积电正处于在其 2 纳米节点中实施背面供电技术的竞争前沿，旨在增强其在 AI 芯片市场的竞争力。这项创新技术有望通过将供电网络重新定位到硅片背面来提高芯片效率，此举旨在简化电源效率、减少干扰并提高整体性能。英特尔今年在商业化方面处于领先地位，三星电子和台积电紧随其后，准备在 2025 年进行大规模生产，业界对背面供电的变革性影响充满期待。

建议关注：

苹果产业链：立讯精密、领益智造、鹏鼎控股、歌尔股份、瑞声科技、舜宇光学、高伟电子、赛腾股份、中石科技、思泉新材等。

图表 1：重点关注公司及盈利预测

公司代码	名称	2024-10-11		EPS			PE			投资评级
		股价	2023	2024E	2025E	2023	2024E	2025E		
002241.SZ	歌尔股份	22.13	0.32	0.75	1.01	69.16	29.51	21.91	买入	
002475.SZ	立讯精密	42.20	1.53	1.88	2.26	27.58	22.45	18.67	增持	
002600.SZ	领益智造	7.23	1.17	0.36	0.43	6.18	20.08	16.81	买入	
002938.SZ	鹏鼎控股	35.18	1.42	1.72	2.16	24.77	20.45	16.29	买入	
300684.SZ	中石科技	17.67	0.25	0.53	0.77	70.68	33.34	22.95	买入	
301489.SZ	思泉新材	66.97	1.44	1.89	2.47	46.51	35.43	27.11	增持	
603283.SH	赛腾股份	66.51	3.43	4.08	4.79	19.39	16.30	13.89	买入	
2018.HK	瑞声科技	31.4	0.63	1.82	46.06	20.71	1.38	15.67	未评级	
2382.HK	舜宇光学	55.25	1.01	2.59	49.86	24.04	2.10	19.44	未评级	
1415.HK	高伟电子	23.55	0.06	0.19	55.53	27.32	0.11	16.30	未评级	

资料来源：Wind，华鑫证券研究（注：“未评级”盈利预测取自万得一致预期）

1.2、海外龙头一览

10月08日-10月11日当周，海外龙头普遍处于上涨态势。英伟达领涨，涨幅为7.91%。

图表 2：海外龙头估值水平及周涨幅

	证券代码	证券简称	国家/地区	市值(亿元)	PE(LYR)	PB(MRQ)	周涨跌幅(%)
处理器	INTC.O	英特尔(INTEL)	美国	1,007	60	1	4.29
	QCOM.O	高通(QUALCOMM)	美国	1,894	26	8	0.64
	AMD.O	超威半导体(AMD)	美国	2,717	318	5	-1.76
	NVDA.O	英伟达(NVIDIA)	美国	33,066	111	57	7.91
存储	MU.O	美光科技(MICRON TECHNOLOGY)	美国	1,185	152	3	4.68
模拟	TXN.O	德州仪器(TEXAS INSTRUMENTS)	美国	1,873	29	11	1.18
	ADI.O	亚德诺(ANALOG)	美国	1,156	35	3	2.03
	AVGO.O	博通(BROADCOM)	美国	8,476	60	13	2.74
	NXPI.O	恩智浦半导体(NXP SEMICONDUCTORS)	荷兰	607	22	7	1.65
射频	SWKS.O	思佳讯(SKYWORKS)	美国	155	16	2	0.49
	QRVO.O	QORVO	美国	97	-137	3	-0.17
功率半导体	STM.N	意法半导体	荷兰	252	6	1	-1.72
	ON.O	安森美半导体(ON)	美国	301	14	4	-1.69

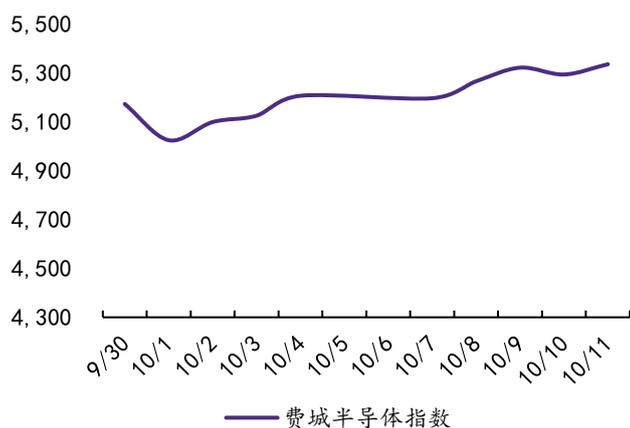
SEMI CONDUCTOR)							
	IFX. DF	英飞凌科技	德国	397	13	2	0.16
光学	3008. TW	大立光	中国台湾	3,257	18	2	-4.50
半导体设备	AMAT. O	应用材料 (APPLIED MATERIAL)	美国	1,691	25	9	1.53
	LRCX. O	拉姆研究 (LAM RESEARCH)	美国	1,074	28	13	1.66
	KLAC. O	科天半导体 (KLA)	美国	1,077	39	32	2.08
	ASML. O	阿斯麦	荷兰	3,317	39	21	0.92
硅片	6488. TWO	环球晶圆	中国台湾	1,946	10	2	-1.11
光刻胶	4185. T	JSR (退市)	日本	9,034	57	2	0.00
晶圆代工	2330. TW	台积电	中国台湾	318,436	32	7	6.96
	GFS. O	格芯 (GLOBALFOUNDRIES)	开曼群岛	225	22	2	3.03
化合物半导体	3105. TWO	稳懋	中国台湾	547	-687	1	-2.64
封装	ASX. N	日月光投资	中国台湾	219	21	2	1.22
分销	ARW. N	艾睿电子 (ARROW ELECTRONICS)	美国	71	8	1	2.00
	AVT. O	安富利 (AVNET)	美国	48	10	1	1.79

资料来源: wind, 华鑫证券研究, 截 10 月 11 日收盘价

更宏观角度, 我们可以用费城半导体指数来观察海外半导体行业整体情况。该指数涵盖了 17 家 IC 设计商、6 家半导体设备商、1 家半导体制造商和 6 家 IDM 商, 且大部分以美国厂商为主, 能较好代表海外半导体产业情况。

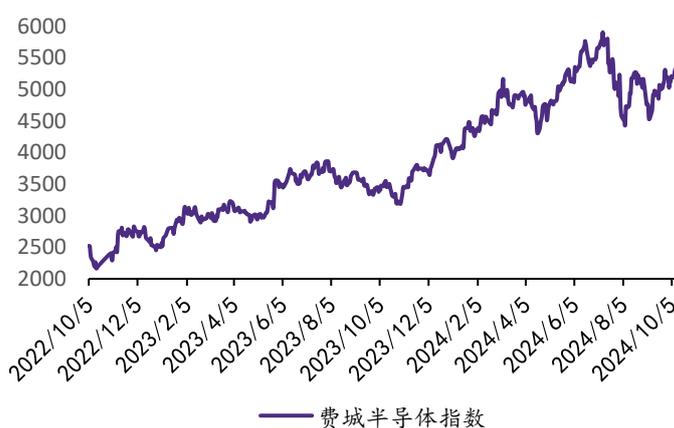
从数据来看, 10 月 08 日-10 月 11 日当周, 费城半导体指数总体呈现上涨态势, 近两周整体处于波动上涨态势。更长时间维度上来看, 指数在进入 2022 年下行通道后, 2023 年 1-6 月, 复苏迹象明显, 处于震荡上行行情; 7 月以来处于下行行情; 10 月底开始持续上涨。2024 年上半年整体处于上升态势, 7 月出现大幅回调, 8 月处于震荡下行行情, 9 月出现探底回升。

图表 3: 费城半导体指数近两周走势



资料来源: wind, 华鑫证券研究

图表 4: 费城半导体指数近两年走势



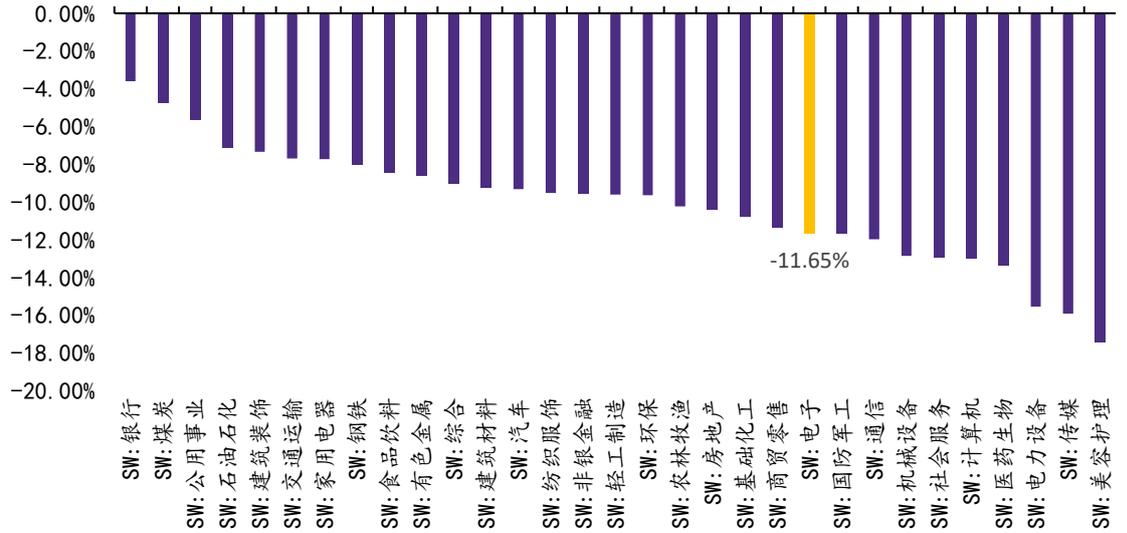
资料来源: wind, 华鑫证券研究

2、周度行情分析及展望

2.1、周涨幅排行

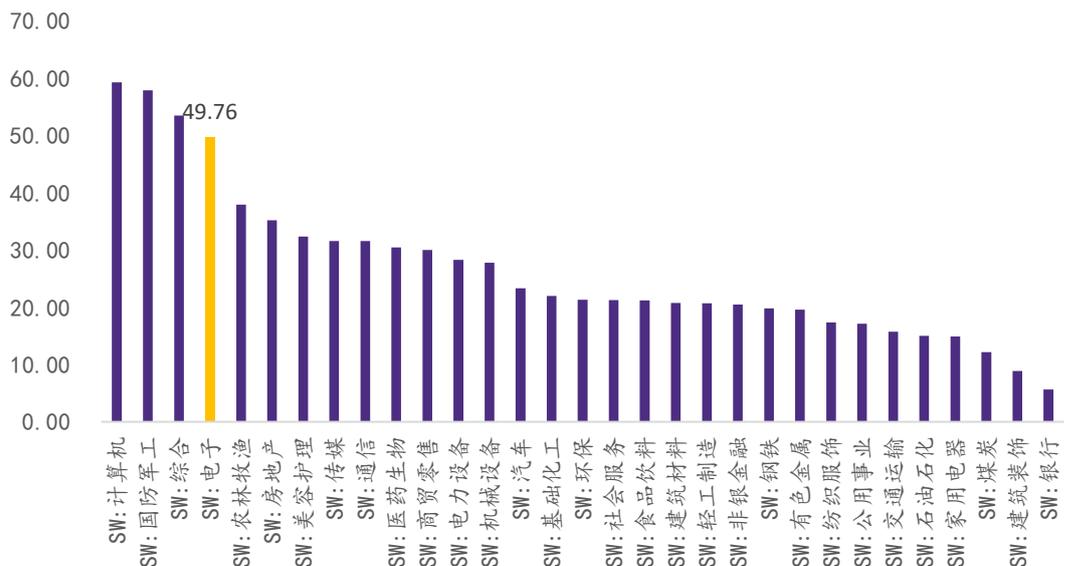
跨行业比较，10月08日-10月11日当周，申万一级行业均处于下跌态势。其中电子行业下跌11.65%，位列第22位。估值前三的行业为计算机、国防军工、综合，电子行业市盈率为49.76。

图表 5：10月08-10月11日行业周涨跌幅比较（%）



资料来源：wind，华鑫证券研究
注：按申万行业一级分类

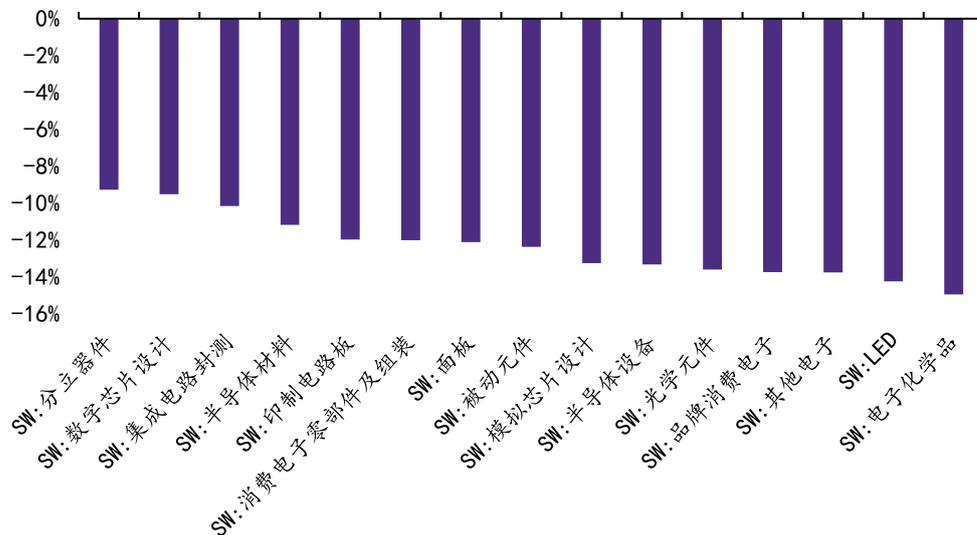
图表 6：10月11日行业市盈率（TTM）比较



资料来源：wind，华鑫证券研究
注：按申万行业一级分类

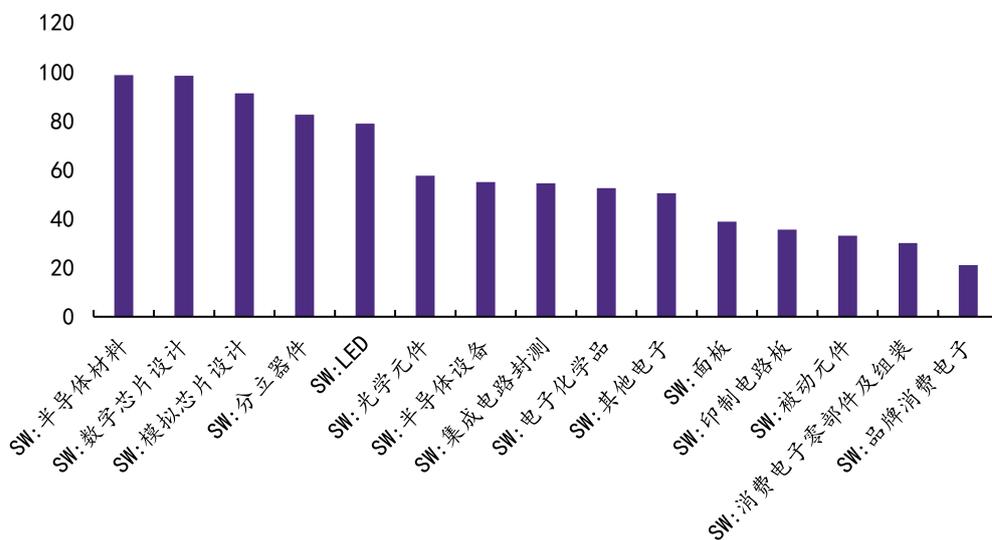
电子行业细分板块比较，10月08日-10月11日当周，电子行业细分板块均处于下跌态势。其中，分立器件、数字芯片设计、集成电路封测板块的跌幅最小。估值方面，半导体材料、数字芯片设计、模拟芯片设计估值水平位列前三，分立器件、LED估值排名本周第四、五位。

图表 7：10月08日-10月11日电子细分板块周涨跌幅比较（%）



资料来源：wind，华鑫证券研究
注：按申万行业三级分类

图表 8：10月11日电子细分板块市盈率（TTM）比较



资料来源：wind，华鑫证券研究
注：按申万行业三级分类

10月08日-10月11日当周，重点关注公司周涨幅前十：数字 IC 占两席，功率半导体、Chiplet、软件、光学元件、半导体材料、模拟 IC、消费电子零部件、电子化学品各占一席。捷捷微电（功率半导体）、润欣科技（Chiplet）、卓朗科技（软件）包揽前三，周涨幅分别为 27.54%、26.88%、23.01%。

图表 9：重点公司周涨幅前十股票

分类	证券代码	证券简称	市值 (亿元) 2024-10-11	ROE (%)	EPS			PE			PB	周涨跌幅 (%)	投资评级
					2023	2024E	2025E	2023	2024E	2025E			
功率半导体	300623.SZ	捷捷微电	236.19	8.94	0.30	0.45	0.61	115.77	71.57	52.96	6.52	27.54	买入
Chiplet	300493.SZ	润欣科技	79.60	9.98	0.07	0.31	0.43	237.01	50.38	36.85	7.27	26.88	未评级
软件	600225.SH	卓朗科技	100.29	0.00	-0.04	0.08	0.13	-67.22	36.87	22.54	5.46	23.01	未评级
数字 IC	300458.SZ	全志科技	217.93	8.18	0.04	0.27	0.51	949.04	126.70	67.68	7.23	21.16	未评级
数字 IC	688385.SH	复旦微电	266.03	13.72	0.88	2.19	2.62	35.52	14.86	12.43	6.09	17.65	未评级
光学元件	688502.SH	茂莱光学	62.30	4.14	0.88	0.99	1.18	133.35	119.82	100.49	5.42	13.60	增持
半导体材料	688126.SH	沪硅产业	590.37	1.11	0.07	0.16	0.20	367.34	138.26	109.33	4.48	13.22	未评级
模拟 IC	688368.SH	晶丰明源	64.96	0.86	-1.45	1.74	3.30	-82.04	59.59	31.23	4.92	13.07	未评级
消费电子零部件及组装	300709.SZ	精研科技	80.12	11.84	0.89	1.62	2.14	50.89	26.62	20.08	3.82	12.14	买入
电子化学品	300054.SZ	鼎龙股份	248.93	10.03	0.23	0.47	0.67	86.51	55.94	39.89	5.96	11.24	增持

资料来源：wind，华鑫证券研究，截至 10 月 11 日收盘价

2.2、行业重点公司估值水平和盈利预测

图表 10：行业重点关注公司估值水平及盈利预测

分类	证券代码	证券简称	市值 (亿元) 2024-10-11	ROE (%)	EPS			PE			PB	投资评级
					2023	2024E	2025E	2023	2024E	2025E		
Chiplet	300493.SZ	润欣科技	79.60	9.98	0.07	0.31	0.43	237.01	50.38	36.85	7.27	未评级
EDA	688206.SH	概伦电子	77.39	-2.02	-0.13	0.18	0.23	-131.73	99.22	78.97	3.85	未评级
LED	002449.SZ	国星光电	47.31	0.00	0.14	0.41	0.51	55.31	18.78	14.88	1.24	未评级
	600363.SH	联创光电	121.95	10.66	0.75	1.06	1.32	29.99	25.20	20.36	2.93	买入
LED&SiC	600703.SH	三安光电	617.64	2.93	0.07	0.23	0.32	168.50	54.18	38.27	1.68	未评级
LED 设备	688383.SH	新益昌	56.31	11.09	0.59	1.79	2.57	101.68	30.77	21.49	3.96	买入
PCB	002436.SZ	兴森科技	167.10	4.64	0.13	0.14	0.31	134.68	70.51	31.59	3.23	增持
	300903.SZ	科翔股份	32.14	0.00	-0.38	0.57	0.00	-18.67	13.73	0.00	1.53	未评级
	603920.SH	世运电路	160.79	14.85	0.92	0.98	1.21	34.44	24.85	20.12	3.17	买入
	688020.SH	方邦股份	26.23	0.75	-0.85	0.64	1.25	-40.56	50.45	26.23	1.82	未评级
半导体材料	605358.SH	立昂微	160.93	2.33	0.10	0.93	1.24	-604.43	25.63	19.25	2.14	未评级
	688126.SH	沪硅产业	590.37	1.11	0.07	0.16	0.20	367.34	138.26	109.33	4.48	未评级
	688234.SH	天岳先进	252.11	3.44	-0.11	0.53	0.83	-551.42	111.06	70.62	4.83	买入
半导体设备	300812.SZ	易天股份	29.35	0.00	0.15	0.50	1.07	238.79	41.93	19.57	3.45	未评级
	688012.SH	中微公司	1047.27	9.76	2.88	2.94	3.58	58.70	57.35	47.15	5.76	买入
被动元件	000636.SZ	风华高科	173.20	3.65	0.15	0.76	0.98	95.60	19.73	15.34	1.44	未评级
	002138.SZ	顺络电子	217.95	13.21	0.79	1.05	1.28	29.45	25.79	21.12	3.68	买入
	301099.SZ	雅创电子	41.74	0.00	0.67	1.99	3.24	69.08	26.09	16.12	4.20	未评级
	603738.SH	泰晶科技	53.96	6.65	0.26	1.39	0.00	52.78	13.98	0.00	3.10	未评级
磁性材料	600366.SH	宁波韵升	70.04	4.95	-0.20	0.81	0.00	-30.86	7.79	0.00	1.19	未评级
	300054.SZ	鼎龙股份	248.93	10.03	0.23	0.47	0.67	86.51	55.94	39.89	5.96	增持
	300655.SZ	晶瑞电材	90.70	3.53	0.01	0.43	0.53	894.95	36.28	29.16	3.52	未评级
电子化学品	301489.SZ	思泉新材	38.63	7.70	0.95	1.89	2.47	70.42	35.44	27.20	3.84	未评级
	688106.SH	金宏气体	89.02	11.19	0.65	0.81	1.01	27.13	22.65	18.06	3.23	未评级
	688268.SH	华特气体	61.29	11.57	1.42	2.19	3.04	35.63	23.22	16.75	3.60	未评级
	688371.SH	菲沃泰	42.94	0.00	-0.12	0.91	0.00	-103.34	14.08	0.00	2.24	未评级
封测	002156.SZ	通富微电	339.49	6.46	0.11	0.62	0.83	157.17	36.04	26.96	2.38	未评级
	600584.SH	长电科技	654.03	7.47	0.82	1.32	1.82	44.48	27.62	20.12	2.46	未评级
	688362.SH	甬矽电子	83.72	2.27	-0.23	0.18	0.49	-61.94	111.63	41.86	3.43	买入
	688372.SH	伟测科技	59.25	4.74	1.04	1.36	2.15	50.21	38.47	24.18	2.39	买入
	688403.SH	汇成股份	72.32	6.60	0.23	0.28	0.33	36.90	31.44	26.30	2.37	未评级
功率半导体	300623.SZ	捷捷微电	236.19	8.94	0.30	0.45	0.61	115.77	71.57	52.96	6.52	买入
	600460.SH	士兰微	402.71	1.41	-0.02	0.18	0.35	-623.79	136.51	68.49	3.35	买入
	605111.SH	新洁能	141.13	11.30	1.08	1.01	1.30	44.42	33.68	26.18	3.76	买入
	688261.SH	东微半导	55.05	3.54	1.48	7.67	9.74	39.32	10.65	8.39	1.91	未评级
	688711.SH	宏微科技	37.40	8.39	0.76	1.70	2.59	32.75	14.50	9.49	3.42	未评级
光刻胶	603306.SH	华懋科技	68.09	9.00	0.74	1.61	1.97	29.82	12.97	10.57	2.03	未评级
光芯片	688498.SH	源杰科技	110.07	3.14	0.23	1.64	2.15	565.03	79.18	60.15	5.26	未评级
光学元件	002036.SZ	联创电子	90.08	-0.07	-0.93	0.80	0.00	-8.50	10.64	0.00	3.37	未评级
	002222.SZ	福晶科技	122.22	13.70	0.49	0.50	0.61	58.01	52.23	42.88	8.07	未评级

	002456.SZ	欧菲光	307.16	0.00	0.02	0.29	0.61	414.83	32.16	15.43	8.66	未评级
	301421.SZ	波长光电	56.34	0.00	0.47	0.75	1.08	108.19	65.52	45.07	4.79	未评级
	603297.SH	永新光学	73.58	13.81	2.12	2.70	3.54	31.35	24.53	18.68	4.06	增持
	688010.SH	福光股份	25.80	0.00	-0.43	0.43	0.61	-37.47	39.09	27.45	1.56	未评级
	688195.SH	腾景科技	36.09	7.66	0.32	0.58	0.80	87.49	48.77	34.70	3.96	买入
	688502.SH	茂莱光学	62.30	4.14	0.88	0.99	1.18	133.35	119.82	100.49	5.42	未评级
	688167.SH	炬光科技	50.64	1.30	1.00	1.52	2.56	55.93	36.96	21.92	2.21	未评级
环保设备 III	688376.SH	美埃科技	48.80	12.27	1.29	1.73	2.23	28.23	21.03	16.27	2.89	未评级
	002008.SZ	大族激光	245.16	10.96	0.78	2.25	0.00	26.91	10.35	0.00	1.56	未评级
激光设备	688025.SH	杰普特	37.15	7.95	1.13	2.23	3.34	35.65	17.61	11.72	1.91	未评级
	688170.SH	德龙激光	23.92	4.49	0.38	0.55	0.93	61.25	41.96	24.91	1.90	未评级
家电零部 件	300475.SZ	香农芯创	138.92	15.69	0.83	0.85	1.01	37.01	35.62	30.20	5.04	增持
金属制品	873693.BJ	阿为特	20.95	0.00	0.32	0.48	0.54	90.74	59.86	53.72	6.10	未评级
军工电子	300045.SZ	华力创通	136.64	2.22	0.03	0.08	0.15	731.94	248.44	136.64	7.84	未评级
	002387.SZ	维信诺	104.36	-35.09	-2.68	-0.28	0.03	-2.30	-26.83	222.04	1.54	未评级
	002876.SZ	三利谱	37.80	6.48	0.25	1.40	2.31	88.03	15.49	9.43	1.61	未评级
面板	300088.SZ	长信科技	154.66	6.80	0.10	0.31	0.38	52.31	20.35	16.37	1.88	未评级
	300909.SZ	汇创达	39.01	8.85	0.54	1.51	1.97	44.82	14.94	11.44	2.01	买入
	603773.SH	沃格光电	38.82	3.25	-0.03	0.67	1.13	123.85	25.88	15.40	2.90	买入
	300661.SZ	圣邦股份	426.60	10.21	0.60	0.98	1.57	158.04	92.54	57.57	10.14	买入
	300782.SZ	卓胜微	525.87	8.68	2.10	2.91	3.45	46.98	33.91	28.56	5.21	未评级
	603160.SH	汇顶科技	340.81	8.06	0.36	1.47	1.63	206.49	50.57	45.50	4.07	未评级
	688052.SH	纳芯微	184.15	-3.13	-2.14	4.14	5.01	-60.31	31.48	25.97	3.03	未评级
	688173.SH	希荻微	45.01	-8.06	-0.13	-0.34	-0.03	-83.07	-31.92	-321.51	2.69	增持
模拟 IC	688220.SH	翱捷科技-U	173.18	-8.26	-1.21	-0.38	0.13	-34.24	-108.24	314.87	2.87	未评级
	688368.SH	晶丰明源	64.96	0.86	-1.45	1.74	3.30	-82.04	59.59	31.23	4.92	未评级
	688458.SH	美芯晟	31.12	2.80	0.38	1.90	2.78	103.20	20.47	14.02	1.55	未评级
	688515.SH	裕太微-U	54.04	-13.08	-1.88	0.99	1.82	-36.00	68.41	37.01	3.20	未评级
	688798.SH	艾为电子	146.81	5.11	0.22	1.33	2.00	287.82	66.73	44.22	3.90	未评级
膜材料	300806.SZ	斯迪克	51.31	5.90	0.12	0.56	1.08	91.54	20.12	10.49	2.33	未评级
品牌分销	002416.SZ	爱施德	123.06	11.40	0.53	0.59	0.67	16.29	16.72	14.86	2.10	买入
品牌整机	688036.SH	传音控股	1142.18	27.71	6.87	8.03	9.40	20.44	17.63	15.06	6.11	买入
其他电子 III	688662.SH	富信科技	23.16	8.54	-0.14	0.71	0.92	-177.50	36.77	28.60	3.44	未评级
其他计算 机设备	300042.SZ	朗科科技	42.28	0.00	-0.22	0.38	0.48	-90.88	56.38	44.05	3.84	未评级
	872190.BJ	雷神科技	15.60	5.10	0.34	0.76	0.98	44.76	20.80	16.08	1.86	未评级
其他专用 设备	688630.SH	芯碁微装	77.81	11.80	1.36	2.15	3.12	43.40	27.59	19.03	3.89	未评级
软件	600225.SH	卓朗科技	100.29	0.00	-0.04	0.08	0.13	-67.22	36.87	22.54	5.46	未评级
	300223.SZ	北京君正	317.93	5.28	1.12	2.36	2.93	61.65	27.94	22.50	2.69	未评级
	300458.SZ	全志科技	217.93	8.18	0.04	0.27	0.51	949.04	126.70	67.68	7.23	未评级
	301308.SZ	江波龙	349.51	17.90	-2.01	0.72	1.24	-41.74	117.28	68.13	5.15	未评级
数字 IC	603501.SH	韦尔股份	1359.55	13.27	0.46	2.38	3.42	250.00	46.96	32.72	6.38	买入
	603893.SH	瑞芯微	284.44	11.65	0.32	0.86	1.20	210.88	78.79	56.78	9.15	未评级
	603986.SH	兆易创新	559.33	7.03	0.24	1.49	2.40	347.11	56.27	34.91	3.59	买入
	688018.SH	乐鑫科技	132.72	14.58	1.69	1.70	2.40	97.44	69.85	49.52	6.87	买入

	688099.SH	晶晨股份	281.69	13.10	1.20	1.83	2.96	56.49	36.87	22.77	5.14	买入
	688110.SH	东芯股份	89.69	0.29	-0.69	0.80	1.23	-29.84	25.19	16.43	2.65	未评级
	688123.SH	聚辰股份	86.11	15.57	0.63	2.18	3.18	104.13	25.18	17.22	4.39	买入
	688213.SH	思特威-W	251.61	9.30	0.04	1.00	1.57	1769.95	62.90	40.00	6.47	买入
	688259.SH	创耀科技	40.07	4.60	0.73	1.89	2.44	68.56	26.53	20.55	2.66	未评级
	688262.SH	国芯科技	67.30	0.00	-0.50	1.71	2.44	-39.88	16.41	11.50	2.91	未评级
	688332.SH	中科蓝讯	70.28	8.04	2.10	2.88	3.80	27.93	20.31	15.41	1.84	买入
	688385.SH	复旦微电	266.03	13.72	0.88	2.19	2.62	35.52	14.86	12.43	6.09	未评级
	688486.SH	龙迅股份	58.20	9.24	1.48	2.08	3.03	56.67	40.42	27.71	4.28	未评级
	688521.SH	芯原股份	196.17	-5.60	-0.59	0.06	0.16	-66.17	676.43	242.18	8.12	未评级
	688608.SH	恒玄科技	279.71	5.67	1.03	2.93	4.45	226.25	79.46	52.38	4.49	买入
	688728.SH	格科微	401.53	3.04	0.02	0.10	0.18	832.27	151.52	83.65	5.18	增持
	688766.SH	普冉股份	80.74	11.64	-0.64	2.82	3.39	-167.25	27.09	22.55	3.88	买入
通信工程及服务	603220.SH	中贝通信	90.35	0.00	0.43	0.00	0.00	62.08	0.00	0.00	4.77	未评级
通信网络设备及器件	300308.SZ	中际旭创	1789.83	27.62	2.71	6.02	8.03	81.07	37.02	27.75	11.06	增持
	300394.SZ	天孚通信	559.17	33.51	1.85	3.21	4.85	76.61	44.06	29.21	15.96	买入
通信线缆及配套	600487.SH	亨通光电	420.58	9.86	0.87	1.09	1.30	18.89	15.69	13.08	1.54	未评级
通信终端及配件	832149.BJ	利尔达	22.26	0.00	-0.01	0.33	0.46	-340.42	16.13	11.53	2.96	未评级
	002241.SZ	歌尔股份	756.21	7.80	0.32	0.75	1.01	74.18	29.54	21.86	2.44	买入
	002993.SZ	奥海科技	74.83	10.64	1.60	2.85	3.43	16.99	9.52	7.91	1.54	未评级
	300115.SZ	长盈精密	187.11	11.12	0.07	0.58	0.74	123.78	26.62	21.09	2.47	未评级
	300136.SZ	信维通信	213.83	9.90	0.54	1.10	1.42	40.78	20.04	15.57	3.00	未评级
	300684.SZ	中石科技	52.92	6.85	0.25	0.53	0.77	73.58	33.08	22.91	2.82	买入
消费电子零部件及组装	300709.SZ	精研科技	80.12	11.84	0.89	1.62	2.14	50.89	26.62	20.08	3.82	买入
	300793.SZ	佳禾智能	55.64	4.98	0.39	1.00	0.00	42.05	16.41	0.00	2.30	未评级
	600745.SH	闻泰科技	385.27	3.79	0.95	3.62	0.00	39.86	8.55	0.00	1.09	未评级
	601231.SH	环旭电子	329.56	12.07	0.88	1.99	0.00	16.90	7.50	0.00	1.99	未评级
	603296.SH	华勤技术	556.71	13.16	3.74	3.98	4.82	20.96	19.35	15.97	2.64	未评级
	603380.SH	易德龙	35.81	14.10	0.83	2.03	0.00	26.03	10.92	0.00	2.55	未评级
	688661.SH	和林微纳	38.42	6.45	-0.23	1.92	3.49	-183.74	22.33	12.27	3.18	未评级
	688283.SH	坤恒顺维	28.62	9.55	1.04	2.07	0.00	32.86	16.45	0.00	2.97	未评级
	300354.SZ	东华测试	44.84	22.01	0.63	1.95	2.57	51.10	16.61	12.60	6.30	未评级
	300567.SZ	精测电子	165.88	6.42	0.54	1.51	2.02	185.40	39.50	29.57	5.19	未评级
仪器仪表	688112.SH	鼎阳科技	45.31	10.38	0.98	1.66	2.27	29.18	17.23	12.59	3.06	未评级
	688337.SH	普源精电	60.47	3.74	0.58	1.42	2.02	56.02	23.62	16.61	1.99	未评级
	688628.SH	优利德	38.46	15.40	1.46	2.33	3.08	24.29	14.79	11.21	3.23	未评级

资料来源: Wind, 华鑫证券研究, 截至 10 月 11 日收盘价

3、行业高频数据

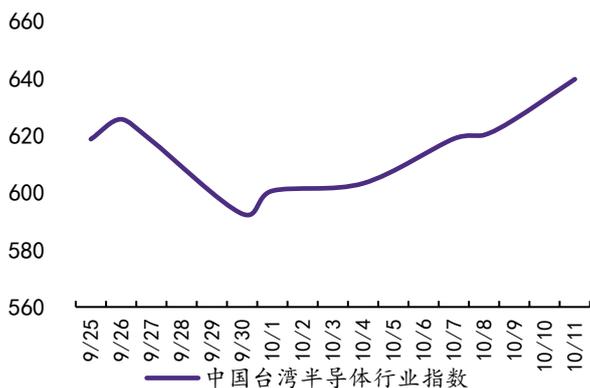
3.1、台湾电子行业指数跟踪

行业指标上，我们依次选取台湾半导体行业指数、台湾计算机及外围设备行业指数、台湾电子零组件行业指数、台湾光电行业指数，来观察行业整体景气。日期上，我们分别截取各指数近两周的日度数据、近两年的周度数据，来考察不同时间维度的变化。

近两周：环比看，9月25日-10月11日两周，台湾半导体行业指数、台湾计算机及外围设备行业指数、台湾电子零组件行业指数总体呈现先跌后涨的态势，台湾光电子行业呈现震荡下跌态势。

近两年：更长时间维度看，台湾电子行业各细分板块指数经过2022年震荡下行后，2023年上半年整体呈现震荡上行趋势，但进入下半年以来复苏放缓。其中台湾计算机及外围设备行业指数2023年7月以来呈现先降后升态势，台湾半导体行业指数、台湾电子零组件行业指数、台湾光电行业指数近期均有所回升。

图表 11：台湾半导体行业指数近两周走势



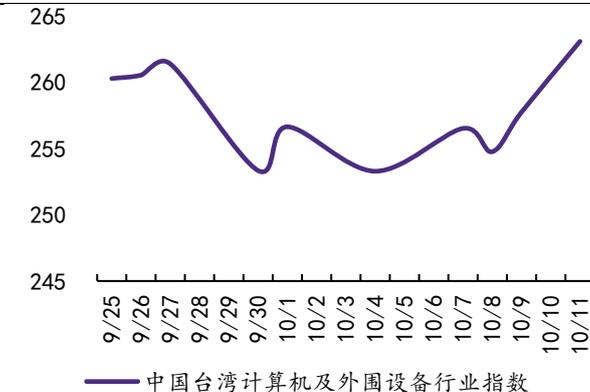
资料来源：wind，华鑫证券研究

图表 12：台湾半导体行业指数近两年走势



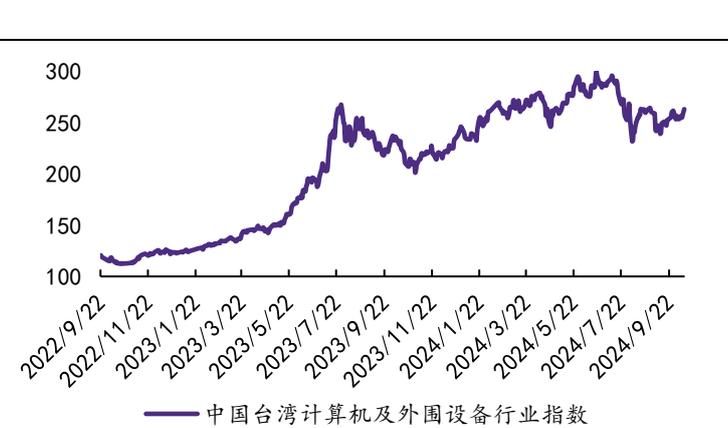
资料来源：wind，华鑫证券研究

图表 13：台湾计算机及外围设备行业指数近两周走势



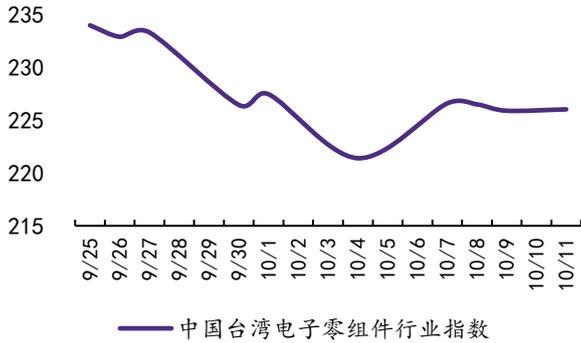
资料来源：wind，华鑫证券研究

图表 14：台湾计算机及外围设备行业指数近两年走势



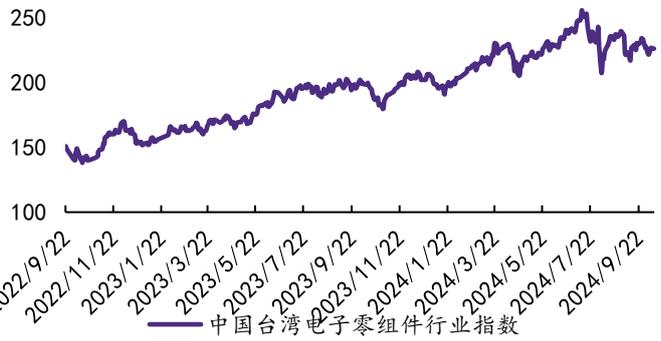
资料来源：wind，华鑫证券研究

图表 15: 台湾电子零组件行业指数近两周走势



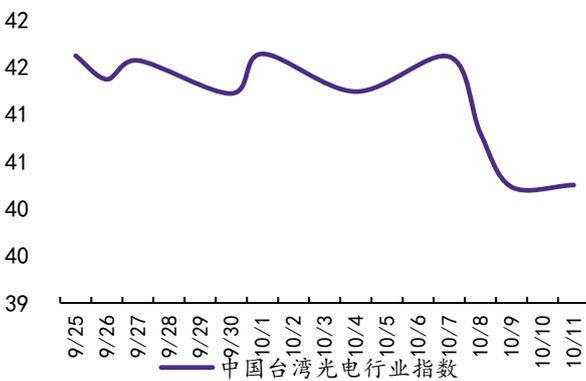
资料来源: wind, 华鑫证券研究

图表 16: 台湾电子零组件行业指数近两年走势



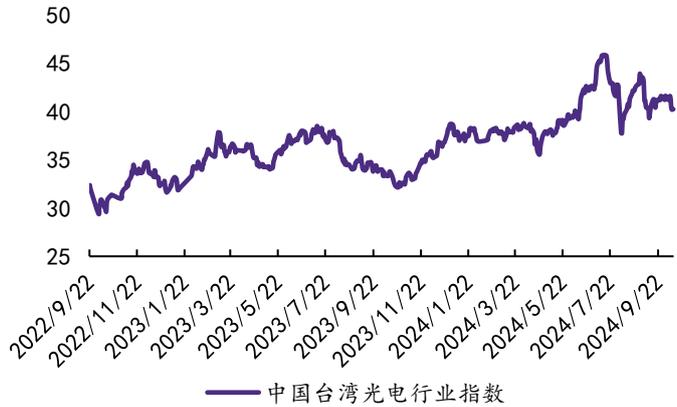
资料来源: wind, 华鑫证券研究

图表 17: 台湾光电行业指数近两周走势



资料来源: wind, 华鑫证券研究

图表 18: 台湾光电行业指数近两年走势

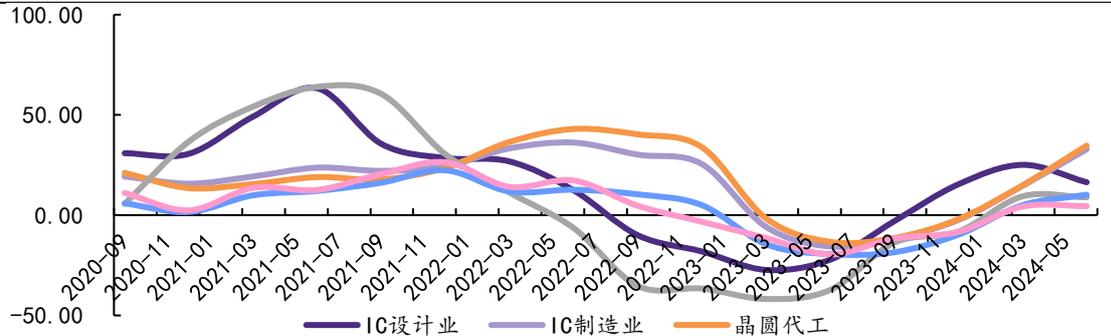


资料来源: wind, 华鑫证券研究

我们可以通过中国台湾 IC 产值同比增速, 将电子各板块合在一起观察:

中国台湾 IC 各板块产值同比增速自 2021 年以来持续下降, 从 2023 年 Q2 开始陆续有所反弹, 各板块产值降幅均有所收窄。IC 板块整体表现不佳, 主要因为消费电子需求差, 导致 IC 设计下滑, 加之 2021 年缺货、涨价导致的 2022 年库存水位上升。但随着 AI、5G、汽车智能化等应用领域的推动, 2024 年需求开始逐步回升。

图表 19: 中国台湾 IC 各板块产值当季同比变化 (%)

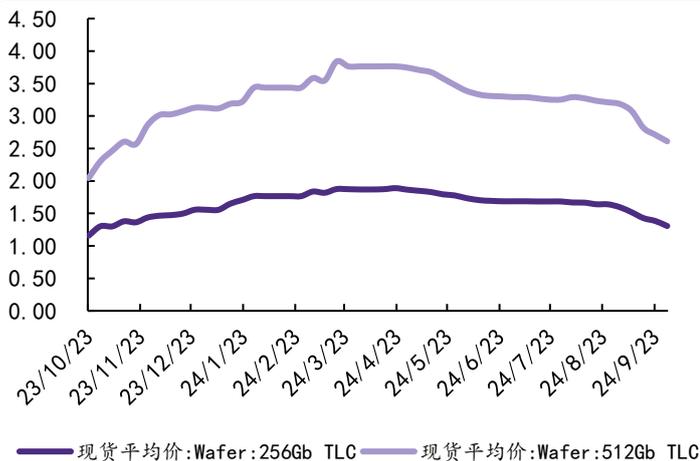


资料来源: wind, 华鑫证券研究

3.2、电子行业主要产品指数跟踪

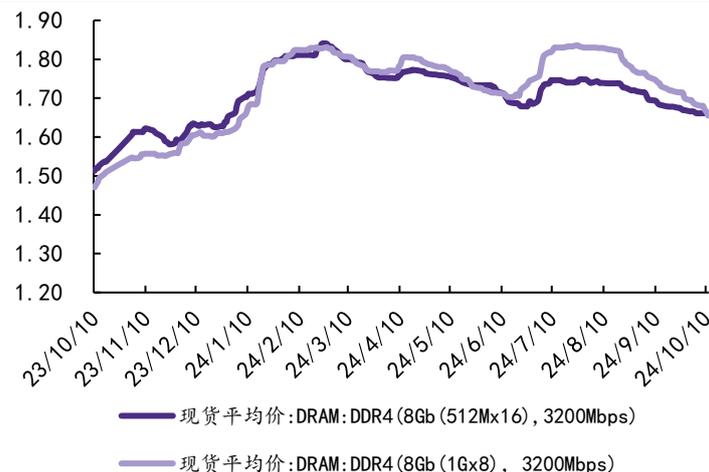
受益于上游头部供应商减产以及 2023 年第四季度消费电子市场有所恢复，存储芯片价格整体呈现回升趋势。NAND 方面：Wafer:512GbTLC 现货平均价从 2023 年 7 月底开始回升，2024 年 9 月 30 日价格为 2.61 美元。DRAM 方面：DRAM:DDR4 (8Gb (512Mx16), 3200Mbps) 现货平均价从 2023 年 9 月中旬开始持续上涨，2024 年 3 月以来价格略有下滑，6 月之后呈现小幅回升态势，9 月之后又重回下跌态势，2024 年 10 月 11 日价格为 1.66 美元。

图表 20: NAND 价格 (单位: 美元)



资料来源: wind, 华鑫证券研究

图表 21: DRAM 价格 (单位: 美元)



资料来源: wind, 华鑫证券研究

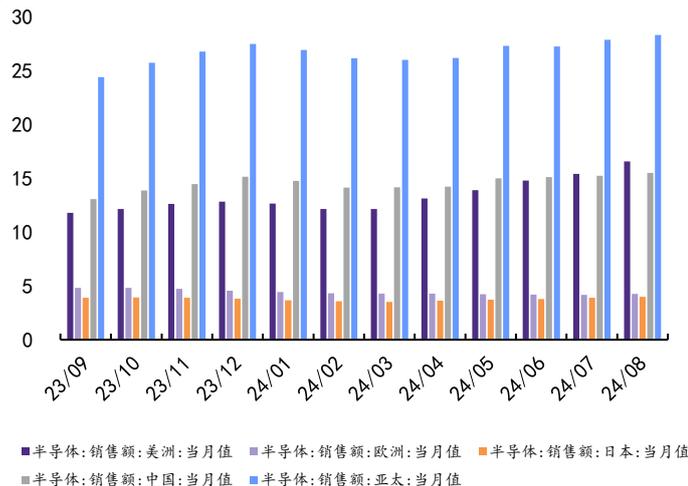
全球半导体销售额自 2024 年 4 月份触底以来逐步攀升。2024 年 8 月，全球半导体当月销售额为 531.2 亿美元，同比增长 20.60%，环比增长 3.51%，其中中国销售额为 154.8 亿美元，环比增长 1.64%，占比达 29.1%。自 2023 年 11 月以来，全球半导体销售额同比连续正增长 10 个月，半导体行业景气度提升显著。

图表 22: 全球半导体销售额 (单位: 十亿美元)



资料来源: wind, 华鑫证券研究

图表 23: 全球分地区半导体销售额 (单位: 十亿美元)

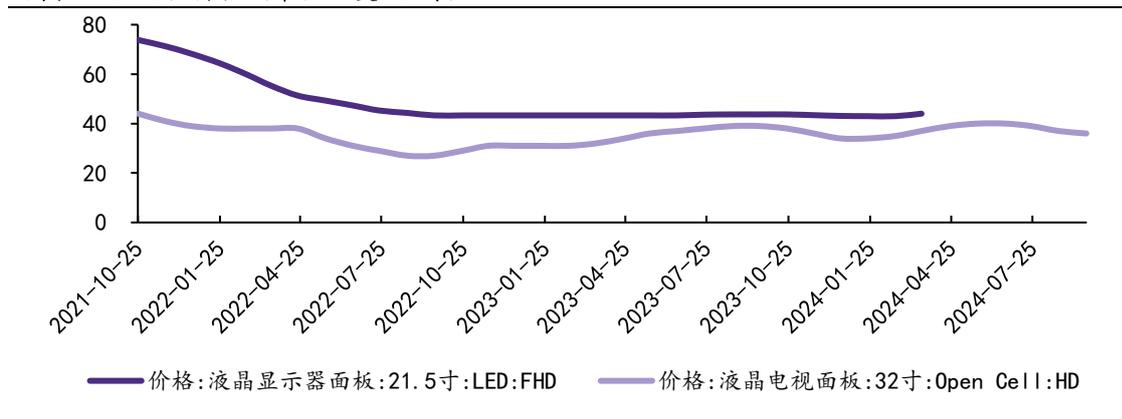


资料来源: wind, 华鑫证券研究

面板价格保持稳定态势。面板价格自 2021 年 7 月以来，价格持续下降，目前价格整体保持稳定，其中液晶电视面板:32 寸:OpenCell:HD 价格近期有所回升，2024 年 9 月 23 日为 36 美元/片，液晶显示器面板:21.5 寸:LED:FHD 价格自 2022 年 8 月 23 日以来，价格逐步由

44.3 美元/片下降至 43 美元/片，2024 年 3 月 22 日价格略有上升，为 44.00 美元/片。

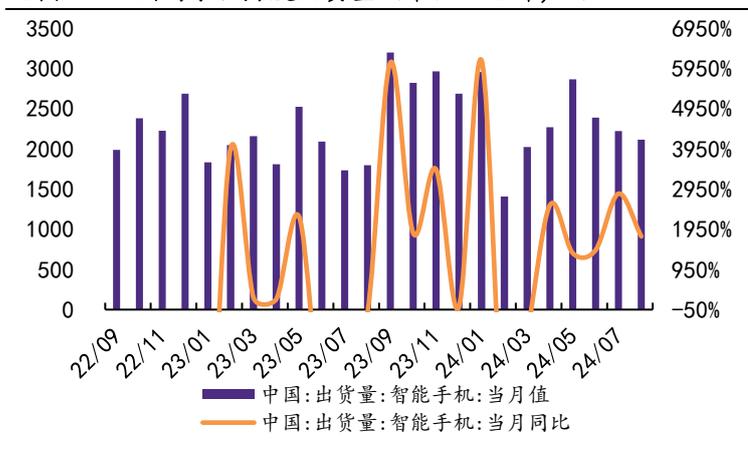
图表 24：面板价格（单位：美元/片）



资料来源：wind，华鑫证券研究

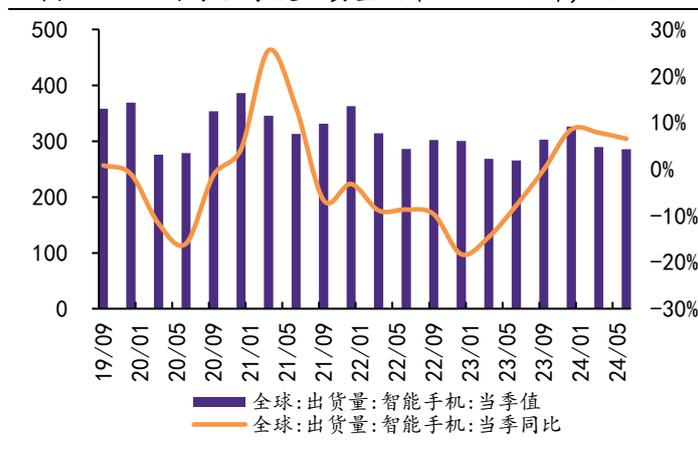
2023H2，国内智能手机出货量同比转正。2024 年 8 月国内手机出货量同比增长 17.70%。全球范围内，2023 年智能手机出货量同比下滑 3.3%，但分季度来看，全球智能手机出货量前三季度同比降幅逐季收窄，2023 年四季度同比变动转正，2024 年二季度全球手机出货量维持上升，同比增长 6.5%。主要由于两个方面，一方面是手机硬件缺乏创新，发达经济体以及中国 5G 周期结束后，消费者换机周期拉长；另一方面中国疫情之后经济复苏不及预期，消费者需求疲软。

图表 25：国内手机月度出货量（单位：万部，%）



资料来源：wind，华鑫证券研究

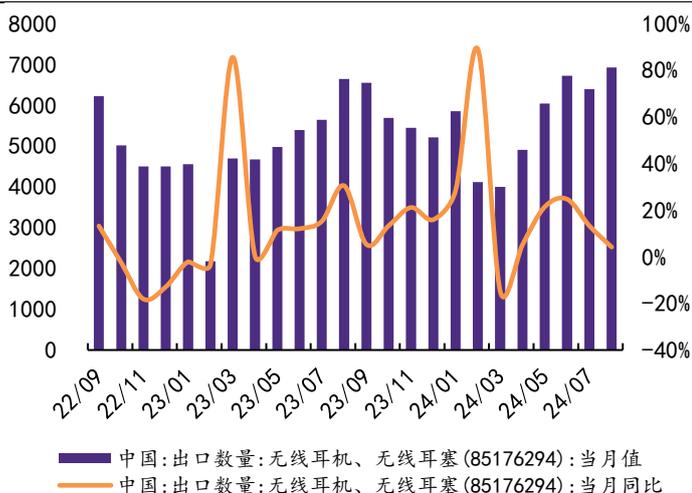
图表 26：全球手机季度出货量（单位：百万部，%）



资料来源：wind，华鑫证券研究

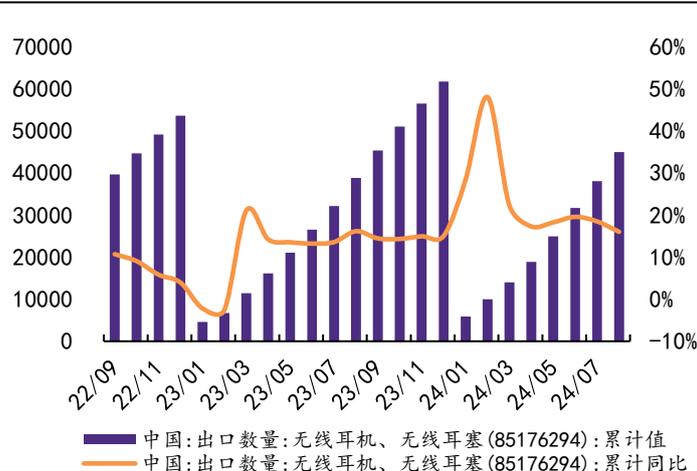
无线耳机方面，国内海关出口数据显示，2023 年以来呈现复苏趋势，全年自 2023 年 2 月以来无线耳机月度出口量同比增幅持续为正，且自 2023 年 9 月以来同比增幅持续扩大。无线耳机技术已经充分成熟，相对于手机消费，无线耳机普及还有空间，随着无线耳机传感器的增多，产品体验感会更加出色，叠加价值量相对手机较小，换机周期会显著快于手机。因此，随着国内的放开和经济复苏，我们继续看好无线耳机这类可穿戴设备的成长。

图表 27: 无线耳机月度出口量 (单位: 个, %)



资料来源: wind, 华鑫证券研究

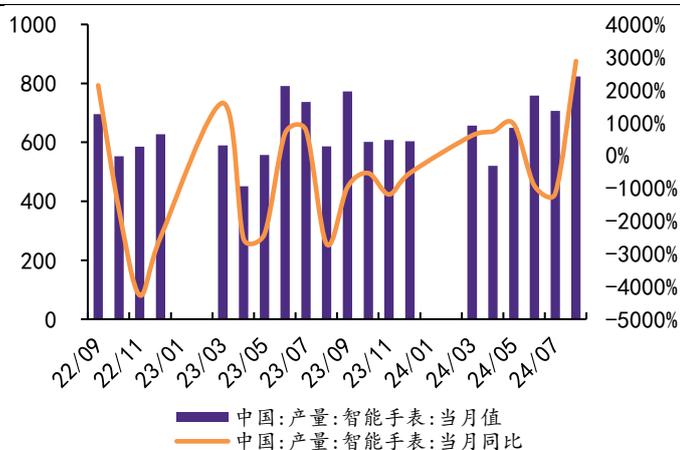
图表 28: 无线耳机累计出口量 (单位: 个, %)



资料来源: wind, 华鑫证券研究

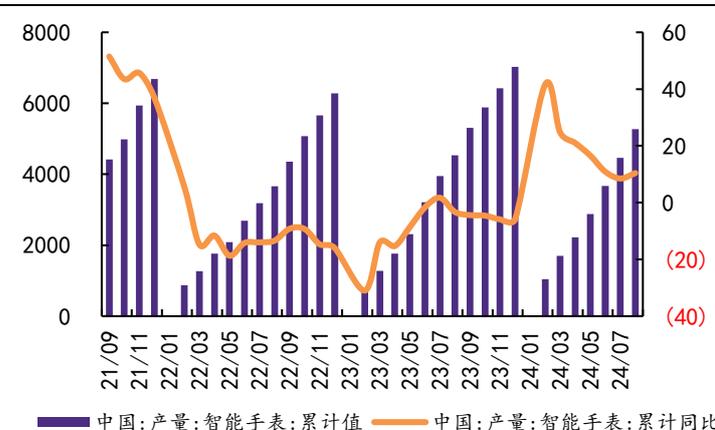
中国智能手表 2023 年全年累计产量同比下降 5.90%; 但进入 2024 年之后出现反弹, 第一季度智能手表累计产量同比增长 24.7%, 打破近两年的持续下滑趋势, 第二季度智能手表累计产量同比增长 10.90%, 增幅有所缩窄。展望 2024 年下半年, 随着生成式 AI 与终端硬件的结合, 智能手表有望集成更多 AI 功能, 从而为市场增长开辟新途径。

图表 29: 中国智能手表月度产量 (单位: 万个, %)



资料来源: wind, 华鑫证券研究

图表 30: 中国智能手表累计产量 (单位: 万个, %)



资料来源: wind, 华鑫证券研究

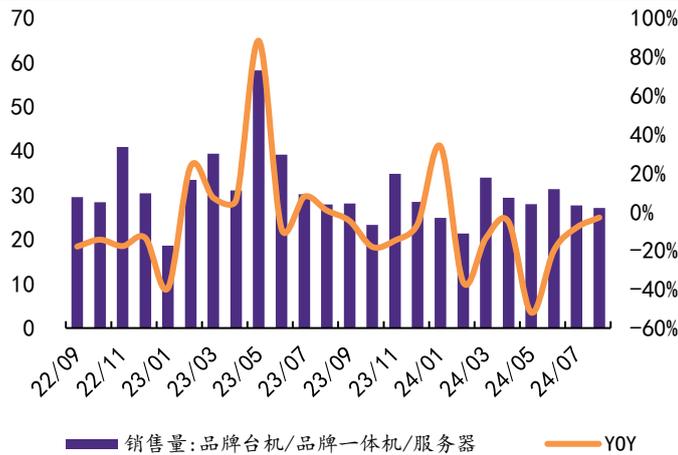
个人电脑方面, 2024H1, 全球 PC 出货量同比上升 1.75%, 扭转了 2022 年下半年以来的下降趋势。回顾历史, 2020-2021 年疫情带来居家办公需求快速上升, 推动 PC 重回增长轨道, 但疫情带来的短期复苏结束后 PC 重回弱势趋势, 在 2022Q2 开始进入下行区间, 2022Q2 全球 PC 出货量同比微增 0.53%, 远低于 Q1 的 11.44% 的增速, 2023H1, 全球 PC 出货量继续下降, 一季度同比下降 29.16%, 二季度同比下降 17.16%; 2023Q3, 出货量同比下降 5.47%, 降幅有所收窄; 2023Q4, 出货量同比下降 2.94%, 降幅进一步收窄。2023 年, 品牌台式机/品牌一体机/服务器出货量累计达 392.58 万件, 同比增长 2.62%。AI 大模型落地给 PC 产业链带来新的创新驱动动力, 另外 PC 换机潮的到来, 2024 年 PC 市场有望恢复增长。

图表 31: 全球 PC 季度出货量 (单位: 百万台, %)



资料来源: wind, 华鑫证券研究

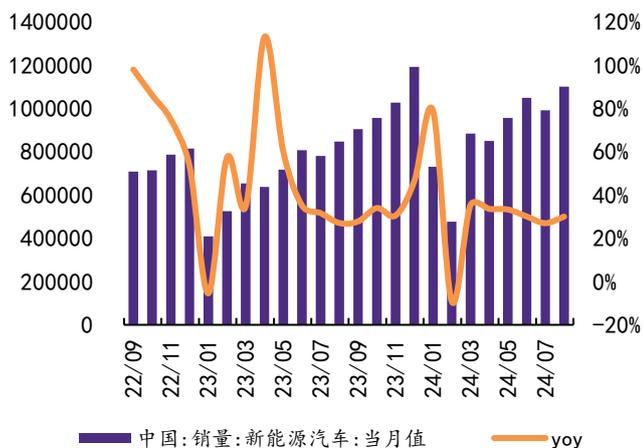
图表 32: 中国台机/服务器月度出货量 (单位: 万台)



资料来源: wind, 华鑫证券研究

随着汽车智能化和电动化带来更好的用户体验以及国家大力推广新能源车, 新能源车销量依旧保持强劲增长势头, 2023 年 1-4 季度分别取得 26.18%、60.92%、28.68%、38.68% 的同比增速。2023 年全年, 新能源汽车累计销量达到 949.52 万辆, 同比增长 37.88%。2024 年第二季度, 新能源汽车销售量同比增长 32.06%。新能源车产业链已经发展成熟, 汽车电动化和智能化带来的电子零部件和汽车半导体的需求将持续保持高成长态势。

图表 33: 中国新能源车月度销售量 (单位: 万辆, %)



资料来源: wind, 华鑫证券研究

图表 34: 中国新能源车累计销售量 (单位: 万辆, %)



资料来源: wind, 华鑫证券研究

4、 近期新股

4.1、 珂玛科技（301611.SZ）：国内先进陶瓷材料零部件领先企业

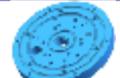
公司主营业务为先进陶瓷材料零部件的研发、制造、销售、服务以及泛半导体设备表面处理服务。公司主要产品及服务包括先进陶瓷材料零部件、表面处理和金属结构零部件。

先进陶瓷材料是采用高度精选或合成的原料，具有精确控制的化学组成，并且具有特定的精细结构和优异性能的陶瓷材料。公司目前拥有由氧化铝、氧化锆、氮化铝、碳化硅、氧化钇和氧化钛 6 大类材料组成的先进陶瓷基础材料体系，半导体设备是公司报告期内先进陶瓷材料零部件的最主要应用。此外，公司先进陶瓷产品亦批量应用于显示面板、LED 和光伏等其他泛半导体设备中，以及电子（含锂电池）材料粉体粉碎和分级、燃料电池制造、化工环保、汽车制造、生物医药和纺织等领域。

表面处理方面，报告期内公司表面处理服务面向显示面板制造厂和设备制造原厂，主要为显示面板工艺设备零部件提供清洗和再生改造服务。

图表 35：珂玛科技产品矩阵

系列	描述	类别	图示
先进陶瓷 圆环圆筒 类	产品主要用于薄膜沉积设备、刻蚀机、离子注入设备以及各类半导体前道设备，部分产品与晶圆直接接触	摩尔环	
		保护环	
		边缘环	
		聚焦环	
		防护罩	
		接地卡环	
		内衬	
		热电偶保护管	
		保温筒	

<p>先进陶瓷 气流导向类</p>	<p>此类产品主要用于引导气体流向，协助工艺气体分布更均匀，且流速稳定，形成工艺环境。喷嘴盖板是喷嘴的安装依附部件，并可吸附工艺残留物</p>	<p>喷嘴</p>	
	<p>气流分配盘</p>		
	<p>限制环</p>		
	<p>扩散板</p>		
	<p>喷嘴盖板</p>		
<p>先进陶瓷 承重固定类</p>	<p>公司的核心产品品类之一，主要用于薄膜沉积设备、刻蚀机、氧化扩散设备、沉积设备和各类半导体前道设备</p>	<p>晶圆载台</p>	
	<p>起模顶杆</p>		
	<p>轴承</p>		
	<p>导轨</p>		
	<p>陶瓷螺杆</p>		
<p>先进陶瓷 手爪垫片类</p>	<p>主要用于各类半导体前道设备，帮助晶圆在腔室内外传送；防止电流导通，部分亦发挥绝热功能和设备零部件冷却</p>	<p>陶瓷帽</p>	
	<p>机械手臂</p>		
	<p>绝缘件</p>		
<p>散热片</p>			
<p>先进陶瓷 模块</p>	<p>产品主要用于刻蚀设备、薄膜沉积设备、激光退火设备、部分薄膜沉积设备、氧化扩散设备</p>	<p>真空吸盘</p>	
	<p>陶瓷加热器（量产）</p>		
	<p>静电卡盘（部分型号量产）</p>		
<p>表面处理 服务</p>	<p>公司的表面处理业务既是先进陶瓷材料零部件新品制造的重要后道工序之一，同时也对外提供专业三方表面处理服务。作为</p>	<p>超高纯 碳化硅套件（客户验证）</p>	
<p>精密清洗</p>			

先进陶瓷材料零部件新品制造工序方面，公司采用精密清洗严格量化控制表面颗粒物、金属离子等污染物，并采用喷砂和熔射等形成特定表面涂层和形貌。

阳极氧化



等离子熔射



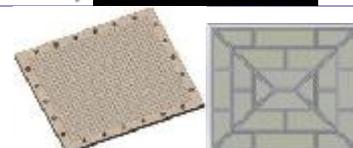
TWAS 双电弧铝熔射



金属结构零部件

公司金属结构零部件产品用于显示面板生产设备，包括上部电极、壁板等，该产品综合运用了精密加工、阳极氧化和熔射等多种技术和制造手段

上部电极

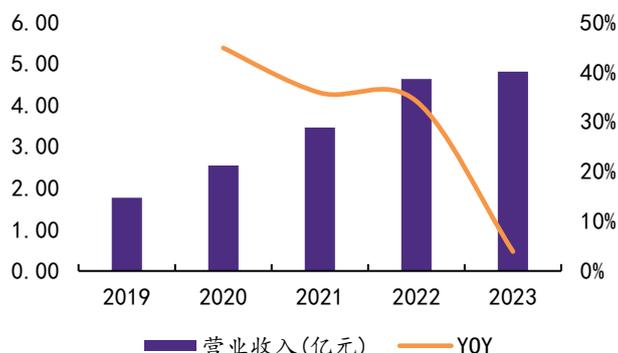


壁板

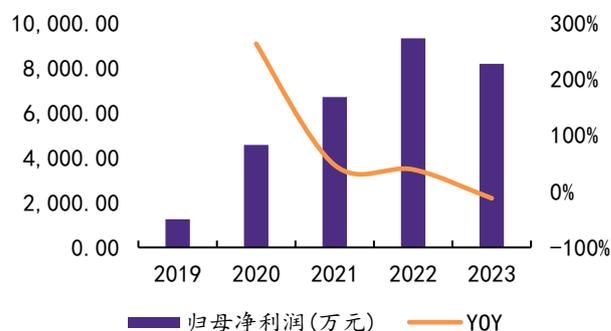
资料来源：珂玛科技招股书，华鑫证券研究

2023 年公司主营业务营收 4.80 亿元，2021 年至 2023 年年均复合增长率为 18.01%，2023 年实现归属于母公司股东的净利润 8,186.07 万元，2021-2023 年均复合增长率为 10.46%。公司 2021-2023 分别实现营业收入 34,501.58 万元、46,246.94 万元和 48,044.96 万元，2021-2023 年 YOY 依次为 36%、34%、4%；2021-2023 分别实现归母净利润 6,708.88 万元、9,323.62 万元和 8,186.07 万元，YOY 依次为 47%、39%、-12%。报告期内，公司营业收入和盈利均主要源于主营业务，主营业务收入占营业收入比例分别为 99.65%、99.77%和 99.47%。

图表 36：珂玛科技营业收入（亿元）



图表 37：珂玛科技归母净利润（万元）



资料来源：wind，华鑫证券研究

资料来源：wind，华鑫证券研究

4.2、龙图光罩（688721.SH）：国内稀缺独立半导体掩模版供应商

龙图光罩主营业务为半导体掩模版的研发、生产和销售，公司主要产品为掩模版，是集成电路制造过程中的图形转移工具或者母板，承载着图形信息和工艺技术信息。掩模版的作用是将承载的电路图形通过曝光的方式转移到硅晶圆等基体材料上，从而实现集成电路的批量化生产。掩模版广泛应用于半导体、平板显示、电路板、触控屏等领域。

图表 38：龙图光罩产品概况

主要供应商	主要产品	主要客户	终端应用	
 	 功率半导体掩模版 MEMS 传感器掩模版 IC 封装掩模版 电源管理芯片掩模版	集成电路及功率半导体 比亚迪半导体 积塔半导体 华彰宏力 粤芯半导体 晶微电子 新唐科技 燕东微电子 士微半导体 扬杰科技 英诺赛科 英诺赛科 美芯晟科技 芯朋微电子 Chipown 高性能电源及驱动芯片	 清华大学 复旦大学 浙江大学 上海交通大学 华南理工大学 北京航空航天大学 清华大学 浙江大学 华南理工大学 北京航空航天大学 中科院微电子研究所 中国科学院长光所	 新能源 光伏发电 汽车电子 工业控制 无线通讯 物联网 消费电子

资料来源：龙图光罩招股书，华鑫证券研究

公司紧跟国内特色工艺半导体发展路线，不断进行技术攻关和产品迭代，半导体掩模版对应下游半导体产品的工艺节点从 1 μm 逐步提升至 130nm，产品广泛应用于功率半导体、

MEMS 传感器、IC 封装、模拟 IC 等特色工艺半导体领域，终端应用涵盖新能源、光伏发电、汽车电子、工业控制、无线通信、物联网、消费电子等场景。公司已掌握 130nm 及以上节点半导体掩模版制作的关键技术，形成涵盖 CAM、光刻、检测全流程的核心技术体系。在功率半导体掩模版领域，工艺节点已覆盖全球功率半导体主流制程的需求。

公司以特色工艺半导体市场为切入点，紧扣国内半导体厂商的发展需求，不断提升掩模版工艺技术水平和服务能力，逐步进入国内多个大型特色工艺晶圆厂供应商名录，在部分工艺节点上实现了对国外掩模版厂商的国产替代。公司是国家工信部认定的专精特新“小巨人”企业，此外还获得广东省功率半导体芯片掩模版工程技术研究中心认定、广东省专精特新中小企业认定、国家高新技术企业认定等。截至 2023 年 12 月 31 日，公司拥有发明专利 16 项，实用新型专利 27 项，计算机软件著作权 36 项。

图表 39：龙图光罩主要产品营收

单位：万元

项目	2023 年度		2022 年度		2021 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
石英掩模版	17,199.06	78.79%	11,241.10	69.59%	6,038.85	53.12%
苏打掩模版	4,630.21	21.21%	4,912.56	30.41%	5,330.41	46.88%
合计	21,829.27	100.00%	16,153.66	100.00%	11,369.25	100.00%

资料来源：龙图光罩招股书，华鑫证券研究

图表 40：龙图光罩营收占比

单位：万元

项目	2023 年度		2022 年度		2021 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
半导体掩模版	19,893.38	91.13%	13,801.48	85.44%	8,672.51	76.28%
功率半导体	15,044.58	68.92%	9,361.67	57.95%	4,452.81	39.17%
IC 封装	1,655.11	7.58%	1,967.05	12.18%	1,932.69	17.00%
MEMS 传感器	1,044.96	4.79%	846.55	5.24%	723.01	6.36%
其他半导体	2,148.74	9.84%	1,626.21	10.07%	1,563.99	13.76%
光学器件	1,131.07	5.18%	1,347.21	8.34%	1,372.22	12.07%
其他领域	804.81	3.69%	1,004.98	6.22%	1,324.51	11.65%
合计	21,829.27	100.00%	16,153.66	100.00%	11,369.25	100.00%

资料来源：龙图光罩招股书，华鑫证券研究

公司 2023 年度实现营收 2.18 亿元，2020-2023 年 CAGR 为 60.61%。2023 年实现归母净利润 8360.87 万元，2020-2023 年 CAGR 为 79.41%。2020-2023 年分别实现主营业务收入 0.53 亿元、1.14 亿元、1.62 亿元、2.18 亿元，2021-2023 年 YOY 依次为 115.77%、42.08%、35.13%。2020-2023 年分别实现归母净利润 1447.87 万元、4116.42 万元、6448.21 万元、8360.87 万元，2021-2023 年 YOY 依次为 184.30%、56.65%、29.66%。2023 年公司主要产品合计产销率达到 99.95%，2021-2023 年整体产销率实现稳定高于 99.85%。

5、行业动态跟踪

5.1、半导体

2029 年 SoC 芯片市场规模将超 2000 亿美元，RISC-V 和汽车领域前景广阔

根据 MarketsandMarkets 的一份新报告，SoC（片上系统）市场规模预计将从 2024 年的 1384.6 亿美元增长到 2029 年的 2059.7 亿美元；预计从 2024 年到 2029 年，其复合年增长率（CAGR）将达到 8.3%。

报告显示，SoC 市场的增长受到汽车行业 SoC 日益增长的趋势以及物联网和联网设备的采用的推动，这些设备需要 SoC 进行实时处理。此外，人工智能和机器学习技术的激增可能会刺激对片上系统的需求。

按核心架构来看，RISC-V 预计在预测期内将在片上系统市场实现高复合年增长率。鉴于 RISC-V 架构相对于其他架构具有灵活性、成本和可扩展性优势，它必将以更高的速度增长，从而推动其在多样化应用中的广泛采用。

此外，预测期内，汽车领域的 SoC 市场将以最高的复合年增长率增长。因为集成在汽车应用中的 SoC 可提高性能、降低功耗并实现紧凑设计，这使其在众多车辆系统必不可少。尤其是电动汽车在电池管理、动力系统控制和能效优化方面严重依赖复杂的电子设备，所有这些都都需要先进的 SoC。

在全球区域方面，报告期内，预计亚太地区在预测期内的复合年增长率最高。由于消费电子和移动设备相关行业快速增长，亚太地区仍然是全球 SoC 市场最大的收入来源。中国、韩国、日本和印度等其他地区被视为世界主要制造中心，这些地区制造最新的智能手机、平板电脑和其他消费电子产品，这些产品需要最先进的 SoC 来提供高性能、节能和集成功能。此外，汽车和工业自动化是推动亚太地区 SoC 市场发展的另一个主要行业。

（资料来源：集微网）

英伟达、AMD 将推新款 GPU 供应链开启备货

英伟达（NVIDIA）、AMD 市场争夺战，从 AI 芯片一路打到绘图处理器（GPU），两强新一代 AI 芯片陆续面市之际，也将各自推出新款 GPU，近期开始迈入新品备货阶段，台积电（2330）、京元电（2449）、旺矽（6223）、精测（6510）、颖威（6515）等相关半导体链近期跟着动起来，引爆新一波芯片热潮。

业界指出，英伟达以最新 Blackwell 平台打造 GB200、B 系列等 AI 芯片备受关注，预计本季起陆续量产之外，更将 Blackwell 架构应用在消费性市场中，旗下全新 RTX 50 系列显卡最快今年底至明年年初问世，进一步扩大 Blackwell 平台在高速运算（HPC）芯片市场的份额。

AMD 虽然在 AI 芯片市场市占率仍远不及英伟达，在 GPU 领域则紧咬不放。因应英伟达全新 RTX 50 系列显卡问世，传出 AMD 将在明年首季端出以 RDNA 4 架构设计的 Radeon RX 8000 系列显卡应战，初期火力主攻中低阶市场，以寻求拓展更多市占率，透露 AMD 对供应链的拉货力道有机会比过往更强。

供应链透露，英伟达、AMD 两强在 GPU 领域激战，近期陆续向半导体供应链下了大量订单，两大厂不约而同都是找台积电投片，使得台积电先进制程订单持续爆满。其中，英伟达向台积电下订大批 4 奈米制程当中，包含 HPC 及消费性和电竞使用的 GPU，目前正在投片

量产阶段。

AMD 则以台积电 3 奈米投片量产新品，业界研判明年投片动能可望逐季放大。看好 AMD 新显卡销售动能，板卡厂也陆续接获客户订单需求，看好明年上半年开始进入供货阶段。

据了解，英伟达、AMD 新款显卡在台积电投片量产后，将迈入 CoWoS 封装阶段，并委由日月光投控旗下矽品，以及全球最大测试厂京元电进行晶圆测试（CP）及最终测试（FT），同时搭配旺矽、颖葳、精测等测试介面厂的探针卡进行检测，顺势让整个半导体供应链动起来。

（资料来源：集微网）

斥资 2000 万美元！三星囤购 AMD MI300X GPU 用于 AI 开发

三星电子与 Team Red 合作，购买了价值 2000 万美元的 AMD Instinct MI300X GPU，以满足其 AI 需求。

三星电子最近开始测试新购买的 AMD Instinct MI300X GPU。该公司已利用 MI300X 数据中心 GPU 开始其 AI 开发之旅，该公司表示，这些 GPU 比英伟达的数据中心产品更实惠。

与大多数巨头一样，三星电子也在开发自己的 AI，需要强大的芯片来为其系统提供支持。虽然 Meta 和 xAI 等公司选择了英伟达 H100 GPU，但三星正在走一条更实惠的路线。与售价 3 万~4 万美元的英伟达 H100 相比，AMD MI300X 的价格要低得多。尽管这款 GPU 在 AI 工作负载方面落后于英伟达 Hopper 产品线，但就定价而言，它被视为不错的选择。

AMD MI300X 每件售价约为 1 万美元，于 2023 年底发布，是 AMD Instinct 系列的旗舰型号。它配备 19456 个流处理器、304 个计算单元和 192GB HBM3 内存，可用于处理密集型工作负载。因此，对于大型项目来说，这款 GPU 是一种更具成本效益的解决方案。

这些 GPU 已被送往三星研究中心进行测试，该机构是 DX 部门的领先机构。GPU 尚未经过极限测试，但据三星内部人士称，AI 开发需要更多时间才能全面展开。

值得注意的是，三星自己将其 HBM 运送给 AMD 用于 Instinct GPU 系列，并且最近其 HBM3E 内存也已通过英伟达 GPU 的现场质量检查。预计三星未来将继续从 AMD 购买 GPU，两家公司之间的联系将得到进一步加强。

（资料来源：集微网）

台积电 2nm 等先进制程扩厂，高雄 P4、P5 启动环评

台积电高雄厂 P1 厂明年量产，P2、P3 兴建及规划中，高雄市长陈其迈表示，台积电应对全球 AI 芯片等产品需求强劲，P3 厂 10 月会动工，P4、P5 近日启动环评进程。楠梓产业园区已成台积电重地，市民建议直接更名台积电园区。应对南部半导体 S 廊带产业空间策略，中国台湾行政部门去年 7 月核准高雄炼油厂旧址为南部科学园区扩建高雄第三园区（楠梓园区）筹设计划，涵盖事业专用区、绿地、停车场、公园等公共设施用地，引进产业以半导体供应链为主，基地面积约 175.3 公顷，连同路竹及桥头科学园区，由南科管理局管辖。台积电 2nm P1 厂预计明年量产，1500 名员工年底进驻高雄，另 P2 厂预计明年完工，P3 厂在 8 月通过环评，另 P4、P5 厂已申请设厂，用地面积 41 公顷。机构表示，针对台积电 P4、P5 的建厂规划，部门配合台积电公司各项需求进行滚动检讨，保持紧密沟通与合作模式，携手台积电与南科管理局为园区扩区规划进行整备，加速落实半导体先进制程扩大落地高雄。

（资料来源：集微网）

花旗：CoWoS 明年产能将倍增

花旗证券发布报告指出，台积电（2330）2025 年底的 CoWoS 产能调高到每月 9-10 万片，全年产能预估倍增至 70 万片或更多，看好台积电、日月光投控及京元电子。

花旗指出，先进制程及封装技术是人工智能（AI）芯片成功的关键。台积电今年底的 CoWoS 产能为每月 3-4 万片，在买下群创南科四厂之后，到 2025 年底的 CoWoS 产能从 6-7 万片上调到每月 9-10 万片，全年产能预估达 70 万片或更多，两倍于今年预估产能 35 万片。

台积电积极扩张 CoWoS 产能，虽然有些法人担心未来可能有过度供给的问题，但花旗认为先进封装需求的下档风险低。花旗预期，台积电到 2025 年底将升级到 2 纳米制程，3D IC/SOIC 需求持续增加，将足以支撑先进封装的扩产。

花旗预期，台积电扩张产能主要集中在较大型光罩及芯片堆叠（CoW）制程，至于较小尺寸光罩及将堆叠好的芯片封装至基板（WoS）制程，就会与专业封测代工（OSAT）厂合作。花旗预估，日月光投控 / 矽品受惠程度可望高于同业。

至于测试端，花旗指出，虽然日月光投控争取英伟达的测试订单，但京元电子仍将是英伟达的测试业务主要合作伙伴，主要是因为复杂度及测试时间都增加。京元电子拥有在 GPU 预烧测试的专业能力，受惠程度将高于其他同业。

在投资评价方面，台积电为花旗首选，着眼于台积电的获利前景强劲。日月光投控可望受惠于在 WoS 封装制程与台积电密切合作。花旗初评京元电子，预估京元电子的 AI 相关测试营收今年将占总营收比重的约 15%，高于去年的 7%。

5.2、消费电子

传苹果下一代智能眼镜或采用 MicroLED，最早将于 2026 年量产

苹果下一代 Apple Watch Ultra 正在使用 microLED 进行严格测试，但由于高昂的显示屏成本使其无法进行商业发布，该公司放弃了这一计划。据报道，有传言称，苹果公司尚未放弃 microLED，因为它正在为即将推出的智能眼镜做准备。

不过，苹果智能眼镜的开发挑战可能非常艰巨，将在 2027 年某个时候推出其 AR 眼镜。遗憾的是，随时可能出现不为人知的困难阻碍进展。同时，另有行业人士称，苹果计划在这款可穿戴设备上使用 microLED 技术，预计将于 2026 年实现量产。但这并未明确智能眼镜或显示器是否会在这一年份投入量产，因为即使苹果设法突破了大规模生产 microLED 面板的昂贵流程，AR 眼镜也是完全不同的设备领域，要生产出卓越的产品仍存在一些列挑战，包括设备重量、芯片性能和耗电量等。

（资料来源：爱集微）

台积电携手安靠生产苹果 A16 芯片

摩国际封测大厂 Amkor 将与台积电扩大合作，4 日宣布，与台积电签署合作备忘录，将在亚利桑那州提供先进封装测试服务，其中包含整合型扇出（InFO）及 CoWoS 等技术，进一步扩大当地的半导体生态圈。

业界推测，台积电首座亚利桑那州厂量产 4 奈米制程芯片，搭配 Amkor InFO 先进封装，即有可能为苹果 A16 芯片，显示达成美国芯片法案之阶段性目标。

透过半导体封装测试外包（OSAT）协助，台积电完成美国芯片法案关键，将先进制程芯片生产在地化。Amkor 强调，将与台积电力决定合作的封装技术，如整合型扇出（InFO）及 CoWoS，以满足共同客户的产能需求。

Amkor 总部即位于亚利桑纳州，具备地缘优势，与台积电合作亦有迹可循，Amkor 去年 11 月底宣布，投资 20 亿美元在亚利桑那州设厂，而根据该合作备忘录，台积电将采用 Amkor 在亚利桑那州皮奥里亚市兴建的新厂，其所提供的一站式（Turnkey）先进封装与测试服务支援其客户，并特别强调是透过台积电在凤凰城之先进晶圆制造厂生产芯片的客户。

台积电亚利桑那州的 Fab 21，正在生产用于 iPhone14 Pro 之苹果 A16 系统单芯片（SoC），随着产能持续爬坡，产量将持续增加；搭配苹果过往以 InFO 封装之习惯，推测美国制造之苹果芯片明年就会问世。

科技业者分析，台积电 4 奈米先进制程可满足美系客户部分需求，且不乏消费型产品，包含 AMD AI PC 芯片、辉达 B 系列 GPU 等，第二座厂则会以 3 奈米制程，延续客户接续需求；不过目前传出，价格将较台湾贵 3 成。

全球各大芯片公司越来越依赖先进封装技术，来实现在人工智能、高效能运算和行动应用方面的突破，台积电业务开发及全球业务资深副总经理暨副共同营运长张晓强表示，将与 Amkor 这样值得信赖的长期策略伙伴并肩合作，用更多元化的生产基地来支持这些客户。将台积电在凤凰城晶圆制造厂的价值最大化，提供美国客户更完备的服务。

（资料来源：爱集微）

苹果低成本 Vision Pro 将于明年上市，它最有可能搭载哪款芯片组？

一款价格实惠的 Apple Vision Pro 可能会在明年某个时候推出，据报道，这款耳机的功能和硬件都进行了降级，以此降低价格。其中一个妥协是降低芯片组的性能。在这里，我们讨论了一些可能性，同时也考虑到它的最终定位是大众市场。

价格较低的 Apple Vision Pro 可能配备 A18 Pro，它已经视为一款性能强大的 SoC。

之前有报道称，价格较低的 Apple Vision Pro 的降级措施之一就是将从 Mac 芯片组换成 iPhone 芯片组。当前一代 AR 头显采用 M2，尽管是采用较旧的制造工艺批量生产的，但制造 Apple Silicon 还涉及其他成本。例如，增加芯片尺寸会增加生产成本，同时重新设计头显的外部布局以帮助控制其热量。

低成本的 Apple Vision Pro 搭载了 A18 Pro，台积电的第二代 3nm 工艺已经使 SoC 具有极高的能效，无需在头戴式可穿戴设备内部添加功能强大的散热解决方案。这种方法的优势在于，即使使用基本的散热系统也足以控制 A18 Pro 的温度，并且可以减少耳机的体积，使佩戴时不那么疲劳。

M2 和 R1 的配对对于驱动两个 4K 微型 OLED 面板是必要的，但如果 Apple 批准日本显示器提供的样品，价格较低的耳机可能会采用普通的 OLED 屏幕。据报道，该组件的 PPI 为 1,500，不到 Apple Vision Pro 3,386PPI 的一半。简而言之，像素更少意味着 A18 Pro 在处理较低分辨率的混合现实和增强现实应用时不会遇到太大问题。

毕竟，它的多核性能与 M1 相当，在最新的 iOS 18.1 beta 5 中，比较 Geekbench 6 分数时，SoC 仅比 M2 慢一点。简而言之，A18 Pro 拥有足够的火力，可以让低成本的 Apple Vision Pro 处理各种任务。现在，剩下要看的的就是该公司决定走哪条路。。

（资料来源：爱集微）

5.3、汽车电子

特斯拉 Robotaxi 正式亮相，无人驾驶提速

10月11日上午，特斯拉“We, Robot”发布会举办。会上，发布了二款无人驾驶出租车 Robotaxi 亮相，分别为双座版的 Cybercab 和可搭载 20 人版本的客货两用 Cybervan。马斯克将 Robotaxi 称为“交通行业革命”。再加上国内的萝卜快跑、小马智行、文远知行等自动驾驶企业均已纷纷展开布局。无人驾驶的发展正在提速。

此次发布会上，马斯克亲自乘坐 Cybercab 抵达现场，有效烘托了气氛。根据他的介绍，双座版 Cybercab 将不设置方向盘和踏板，完全依赖特斯拉全自动驾驶（FSD）技术。这充分显示了特斯拉在无人驾驶上的决心。特斯拉计划在 2026 年至 2027 年大规模量产该车型，制造成本低于 3 万美元。而为了配合 Cybercab 的量产和商用，无人监督版本的 FSD 将率先在美国的德州和加州推出。现款的 Model 3 和 Model Y 也会实现无人监督版本的 FSD 使用。

特斯拉还首次公布了一款 Robovan 车型，可承载 20 人，也可以进行货物运输，可以大幅降低人们的出行成本。

此次发布会明确了，特斯拉的 Robotaxi 技术路线还将采用 AI+纯视觉的完全无人监督自动驾驶 FSD 方案。Cybercab 的规模量产时间也与此前分析师的预期一致。对此，华泰证券认为，随着特斯拉 Robotaxi 推进，高阶智能驾驶功能将有望愈加受到重视，推动其快速落地。

事实上，国内方面，萝卜快跑、小马智行、文远知行等自动驾驶企业也在纷纷展开布局，以图在无人驾驶方面与特斯拉进行竞争。目前来看，国内无人驾驶企业大致分为两大阵营，包括萝卜快跑、小马智行、文远知行等解决方案提供商，另一方是以蔚小理、小米等为代表的汽车品牌制造商。

当然，从现有自动驾驶升级到完全无需驾驶员监督的高度自动化（比如本次 Cybercab 取消了方向盘和踏板）并非易事。按照马斯克的计划 Cybercab 要到 2026-2027 年才会投入量产，且需在技术和监管层面突破很多障碍。但这一趋势已经明确，无人驾驶正在提速。

（来源：集微网）

比亚迪 9 月销售汽车 41.94 万辆，出口 3.05 万辆

10月7日，比亚迪发布 2024 年 9 月产销快报。报告显示，比亚迪在新能源汽车领域的产量和销量均实现了显著增长。

9 月份比亚迪新能源汽车产量达到 441,052 辆，去年同期为 279,848 辆。本年度累计产量为 2,760,910 辆，同比增长 30.68%。

9 月份，比亚迪新能源汽车销量为 419,426 辆，去年同期销量为 287,454 辆，本年度累计销量为 2,747,875 辆，同比增长 32.13%。

乘用车 9 月份产量为 439,229 辆，去年同期为 279,297 辆；销量为 417,603 辆，去年同期为 286,903 辆；商用车 9 月份产量为 1,823 辆，销量为 1,823 辆。其中，纯电动乘用车 9 月份产量为 170,267 辆，去年同期为 144,179 辆；销量为 164,956 辆，去年同期为 151,193 辆。插电式混合动力乘用车 9 月份产量为 268,962 辆，去年同期为 135,118 辆；销量为 252,647 辆，去年同期为 135,710 辆。

海外销售方面，9 月比亚迪海外销售新能源乘用车合计 33,012 辆，其中出口 30,512 辆。

另外，9 月份比亚迪新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为 19.8 GWh，2024 年

累计装机总量约为 127.72 GWh。

（资料来源：集微网）

通用汽车：正开发新型 L3 级自动驾驶系统，一旦实现将改变行业格局

随着汽车智能化、自动化深入发展，通用汽车正在加强对自动驾驶的布局。据报道，通用汽车软件与服务工程高级副总裁 Dave Richardson 在接受采访时表示，公司正在研发“让驾驶员不再需要盯着路面驾驶”的 L3 级自动驾驶系统。

目前，大部分车企所使用的自动驾驶（辅助 / 智能驾驶）等级为 L2，即只能实现部分自动化，仍需驾驶员时刻注意路况。Dave Richardson 表示，“通用 Super Cruise 是行业领先的 L2 级脱手驾驶系统，但我们正在加紧推动它升级为 L3 级，这样你就不必再盯着路面了。”

他还称，“当我们实现 L3 级自动驾驶时，将达到一个重要的里程碑，也会改变行业格局。不过，关键在于何时达到完全成熟，过早推出可能会让用户失去信任。”这位高管没有透露新版本自动驾驶系统的正式推出时间，也没有透露具体的开发进展。

据了解，通用汽车现有的 Super Cruise 依赖激光雷达地图数据、精确 GPS、摄像头和雷达传感器的配合，还配备驾驶员注意监控系统，确保驾驶员在驾驶时注视前方、观察路况。一旦启动，Super Cruise 可以自动加速或减速，以保持与前车的安全距离，转向以保持车道位置，并自动变道以超越慢车。

（资料来源：集微网）

6、行业重点公司公告

图表 41：本周重点公司公告

公告日期	证券代码	公告标题	主要内容
2024-10-12	002156.SZ	通富微电:大股东减持股份预披露公告	持有通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）股份 170,817,547 股（占公司总股本比例 11.26%）的股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“产业基金”或“首期基金”）计划在本减持计划公告发布之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2024 年 11 月 4 日至 2025 年 2 月 3 日），以集中竞价或大宗交易方式减持持有的公司股份不超过 45,527,907 股（即不超过公司股份总数的 3%）
2024-10-12	300709.SZ	精研科技:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告	江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 11 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》，选举产生了公司第四届董事会非独立董事、第四届董事会独立董事，共同组成第四届董事会；同时本次股东大会也审议通过了《关于监事会换届暨选举第四届监事会股东代表监事的议案》，选举出了第四届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第四届监事会。
2024-10-11	688173.SH	希荻微:持股 5%以上股东减持股份计划公告	截至本公告披露日，希荻微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东深圳辰芯创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳辰芯”）持有公司股份 20,666,667 股，占公司总股本的 5.04%。上述股份均来源于公司首次公开发行前取得的股份，已全部解除限售。
2024-10-10	600584.SH	长电科技:2024 年第三季度营业收入简报	江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第三季度（2024 年 7 月至 9 月）合并营业收入预估为人民币 94.9 亿元左右，较去年同期的合并营业收入同比增加约 14.9%，较第二季度（2024 年 4 月至 6 月）合并营业收入环比增加约 9.8%。主要为部分客户业务上升，产能利用率提高。公司 2024 年 1 月至 9 月合并营业收入预估为人民币 249.8 亿元左右，较去年同期的合并营业收入增加约 22.3%。
2024-10-10	603501.SH	韦尔股份:2024 年前三季度业绩预增公告	公司预计 2024 年前三季度实现归属于母公司所有者的净利润为 226,701.35 万元到 246,701.35 万元，同比增加 515.35%到 569.64%；公司预计 2024 年前三季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 220,213.31 万元到 240,213.31 万元，同比增加 1,595.80%到 1,749.81%。
2024-10-10	300054.SZ	鼎龙股份:关于公司 CMP 抛光垫产品单月销量首次突破 3 万片的自愿性信息披露公告	湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司湖北鼎汇微电子材料有限公司（以下简称“鼎汇微电子”）CMP 抛光垫产品销售持续保持快速增长态势，并于 2024 年 9 月首次实现抛光垫单月销量破 3 万片的历史新高。
2024-10-09	300054.SZ	鼎龙股份:2024 年前三季度业绩预告	2024 年前三季度，累计实现营业收入约 24.10 亿元，其中：第三季度营业收入约 8.92 亿元，环比增长 10%；2024 年前三季度，归属于上市公司股东的净利润预计约为 3.67 亿元至 3.79 亿元，其中：第三季度约为 1.49 亿元至 1.61 亿元，环比较第二季度 1.36 亿元持续稳健增长。
2024-10-09	601231.SH	环旭电子:2024 年 9 月营业收入简报	环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 9 月合并营业收入为人民币 5,952,806,962.62 元，较去年同期的合并营业收入增加 4.19%，较 2024 年 8 月合并营业收入环比增加 12.68%。 公司 2024 年 1 月至 9 月合并营业收入为人民币 44,006,707,552.10 元，较去年同期的合并营业收入增加 2.21%。

2024-10-08	300223.SZ	北京君正:关于公司股东股份减持计划预披露公告	<p>1、北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东北京屹唐盛芯半导体产业投资中心（有限合伙）（以下简称“屹唐盛芯”）计划以集中竞价方式减持所持有的公司股份不超过800,000股，占公司总股本比例不超过0.1661%；</p> <p>2、本次减持计划拟通过集中竞价方式减持，自2024年10月30日至2024年11月10日实施该减持计划，符合首次卖出的15个交易日前预先披露减持计划的要求；</p> <p>3、截至本公告披露日，屹唐盛芯持有公司股份60,546,704股，占本公司总股本比例12.57%。</p>
2024-10-08	300458.SZ	全志科技:2024年前三季度业绩预告	<p>1. 业绩预告期间:2024年1月1日-2024年9月30日</p> <p>2. 2024年前三季度（2024年1月1日-9月30日）业绩预计情况：归属于上市公司股东的净利润为14,000万元-15,600万元，同比亏损2,055.52万元；扣除非经常性损益后的净利润为10,000万元-11,800万元，同比亏损：4,220.94万元</p>
2024-10-08	600703.SH	三安光电:关于获得政府补助的公告	<p>1、2024年7月1日至2024年9月29日，公司及下属子公司收到与收益相关、未履行信息披露义务且未达披露标准的政府补助款约1,040.00万元。</p> <p>2、公司2024年第三季度递延收益分期摊销转入其他收益的金额预计为13,389.00万元。</p> <p>上述两项合计金额约14,429.00万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的39.36%。</p>

资料来源：Wind，华鑫证券研究

通富微电:大股东减持股份预披露公告

持有通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）股份170,817,547股（占公司总股本比例11.26%）的股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“产业基金”或“首期基金”）计划在本减持计划公告发布之日起15个交易日后的3个月内（即2024年11月4日至2025年2月3日），以集中竞价或大宗交易方式减持持有的公司股份不超过45,527,907股（即不超过公司股份总数的3%）。

一、股东基本情况

（一）股东名称：国家集成电路产业投资基金股份有限公司。

（二）股东持股情况：截至本公告披露日，首期基金持有公司股份170,817,547股，占公司总股本的11.26%，均为无限售条件流通股。

二、本次减持计划的主要内容

1、减持原因：自身经营管理需要。

2、股份来源：非公开发行股票方式取得的股份，公司于2018年1月22日披露了《通富微电发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股份上市报告书》；协议转让股份，产业基金已于2018年2月27日披露《简式权益变动报告书》。

3、拟减持股份数量及比例：以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过45,527,907股（即不超过公司股份总数的3%）。其中，通过大宗交易方式减持公司股份不超过30,351,938股（即不超过公司股份总数的2%）；通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过15,175,969股（即不超过公司股份总数的1%）。

4、减持方式：集中竞价/大宗交易。

5、减持期间：在本减持计划公告发布之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2024 年 11 月 4 日至 2025 年 2 月 3 日）。

6、减持价格：按照减持实施时的市场价格确定。

7、其他：在减持计划公告发布之日起至减持计划实施期间，公司如发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，减持股份数量将进行相应调整。

8、本次拟减持事项不存在违反承诺、违反大股东减持相关法律法规的情形。

精研科技:关于董事会,监事会完成换届选举及聘任高级管理人员,证券事务代表的公告

公司第四届董事会组成情况

1、董事会成员

公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，

成员如下：

(1) 非独立董事：王明喜先生（董事长）、黄逸超女士、邬均文先生、马黎达先生；

(2) 独立董事：周健先生、刘永宝先生、王普查先生（会计专业人士）。

公司第四届董事会任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第四届董事会成员任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

公司第四届董事会成员简历详见公司 2024 年 9 月 20 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会换届选举的公告》。

2、董事会各专门委员会委员

公司第四届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会，各专门委员会组成人员如下：

(1) 战略委员会：王明喜先生（主任委员）、黄逸超女士、周健先生；

(2) 审计委员会：王普查先生（主任委员）、刘永宝先生、马黎达先生；

(3) 薪酬与考核委员会：周健先生（主任委员）、王普查先生、邬均文先生；

(4) 提名委员会：刘永宝先生（主任委员）、周健先生、王明喜先生。

各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与

考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事且召集人为会计专业人士。公司第四届董事会各专门委员会委员任期自第四

届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

希荻微:持股 5%以上股东减持股份计划公告

大股东持股的基本情况

截至本公告披露日,希荻微电子集团股份有限公司(以下简称“公司”)股东深圳辰芯创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“深圳辰芯”)持有公司股份 20,666,667 股,占公司总股本的 5.04%。上述股份均来源于公司首次公开发行前取得的股份,已全部解除限售。

减持计划的主要内容

公司于 2024 年 10 月 10 日收到深圳辰芯出具的《关于希荻微电子集团股份有限公司股份减持计划的告知函》,深圳辰芯对公司前景持续看好,为满足自身资金需求,拟通过集中竞价、大宗交易的方式减持其持有的公司股份数量合计不超过 12,309,273 股,占公司总股本的比例合计不超过 3.00%,其中以集中竞价方式减持不超过 4,103,091 股,占公司总股本的比例合计不超过 1.00%,减持期间为本公告披露 15 个交易日后的 3 个月内;以大宗交易方式减持不超过 8,206,182 股,占公司总股本的比例合计不超过 2.00%,减持期间为本公告披露 15 个交易日后的 3 个月内。减持价格按照市场价格确定,若公司在上述减持计划实施期间发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的,则上述减持计划将作相应调整。

一、减持主体的基本情况

股东名称 股东身份 持股数量(股) 持股比例 当前持股股份来源

深圳辰芯创业投资合伙企业(有限合伙)

20,666,667 5.04% IPO 前取得: 20,666,667

长电科技:2024 年第三季度营业收入简报

特别提示:本简报所载财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,最终数据以公司定期报告为准,请投资者注意投资风险。

江苏长电科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年第三季度(2024 年 7 月至 9 月)合并营业收入预估为人民币 94.9 亿元左右,较去年同期的合并营业收入同比增加约 14.9%,较第二季度(2024 年 4 月至 6 月)合并营业收入环比增加约 9.8%。主要为部分客户业务上升,产能利用率提高。

公司 2024 年 1 月至 9 月合并营业收入预估为人民币 249.8 亿元左右,较去年同期的合并营业收入增加约 22.3%。

韦尔股份:2024 年前三季度业绩预增公告

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日

(二)业绩预告情况

预计业绩：同比上升

1、经财务部门初步测算，预计 2024 年前三季度实现归属于母公司所有者的净利润为 226,701.35 万元到 246,701.35 万元，与上年同期相比，将增加 189,860.29 万元到 209,860.29 万元，同比增加 515.35%到 569.64%。

2、经财务部门初步测算，预计 2024 年前三季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 220,213.31 万元到 240,213.31 万元，与上年同期相比，将增加 207,227.50 万元到 227,227.50 万元，同比增加 1,595.80%到 1,749.81%。

3、经财务部门初步测算，预计 2024 年前三季度实现营业收入为 1,874,140.67 万元到 1,899,140.67 万元，与上年同期相比，将增加 365,999.76 万元到 390,999.76 万元，同比增加 24.27%到 25.93%。

(三) 公司本次业绩预告未经会计师事务所审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

(一) 归属于母公司所有者的净利润：36,841.06 万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：12,985.81 万元；营业收入：1,508,140.91 万元。

(二) 每股收益：0.31 元/股。

三、本期业绩预告预增的主要原因

本报告期内，市场需求持续复苏，下游客户需求有所增长，伴随着公司在高端智能手机市场的产品导入及汽车市场自动驾驶应用的持续渗透，公司的营业收入和毛利率实现了显著增长；此外，为更好的应对产业波动的影响，公司积极推进产品结构优化及供应链结构优化，公司产品毛利率逐步恢复，整体业绩显著提升。

鼎龙股份:关于公司 CMP 抛光垫产品单月销量首次突破 3 万片的自愿性信息披露公告

湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司湖北鼎汇微电子材料有限公司（以下简称“鼎汇微电子”）CMP 抛光垫产品销售持续保持快速增长态势，并于 2024 年 9 月首次实现抛光垫单月销量破 3 万片的历史新高。

公司作为国内唯一一家全面掌握抛光垫全流程核心研发和制造技术的 CMP 抛光垫国产供应商，产品深度渗透国内主流晶圆厂客户，渗透程度随订单增长稳步加深，在国内市场的市占率水平也在不断提升中，CMP 抛光垫国产供应龙头地位持续巩固。

目前，公司具备武汉年产 40 万片硬垫及潜江年产 20 万片软垫及抛光垫配套缓冲垫的现有产能条件。同时，公司已启动武汉硬垫产线的产能扩充计划，预计将于 2025 年第一季度完成月产 4 万片（即年产 48 万片）的达产。此外，公司适当增加设备投入和 9 个月左右时间，可将其产能进一步提升至月产 5 万片（即年产 60 万片）的产能条件。后续，公司将视半导体下游产业规模及客户需求等变化趋势、及该产品的销量情况，提前做好持续产能补充，为 CMP 抛光垫产品销售持续增长提供坚实的产能基础。公司也将紧抓市场机遇，努力推动 CMP 抛光垫业务持续稳健增长。

以上销量数据源自公司内部统计，未经审计，据此难以准确推算公司全年营业收入、净利润等财务数据，仅供投资者及时了解公司日常经营概况。具体准确的财务数据以公司正式披露的定期报告为准。请广大投资者注意投资风险。

鼎龙股份:2024 年前三季度业绩预告

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2024年1月1日—2024年9月30日

2、业绩预告情况：同向上升

3、业绩预告情况表

(1) 2024年前三季度（2024年1月1日—2024年9月30日）业绩预计情况

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利：36,661.69万元-37,895.49万元 比上年同期上升：108% -115%	盈利：17,625.81万元
扣除非经常性损益后的净利润	盈利：33,847.12万元-35,080.92万元 比上年同期上升：161% -171%	盈利：12,944.90万元

(2) 2024年第三季度（2024年7月1日—2024年9月30日）业绩预计情况

项目	2024年第三季度	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利：14,877.64万元-16,111.44万元 比上年同期上升：85% -100%	盈利：8,038.64万元
扣除非经常性损益后的净利润	盈利：14,179.75万元-15,413.55万元 比上年同期上升：131% -151%	盈利：6,131.04万元

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

公司是国内领先的关键大赛道领域中各类核心“卡脖子”进口替代类创新材料的平台型公司，目前重点聚焦半导体创新材料领域。

2024年前三季度，累计实现营业收入约24.10亿元，其中：第三季度营业收入约8.92亿元，环比增长10%；2024年前三季度，归属于上市公司股东的净利润预计约为3.67亿元至3.79亿元，其中：第三季度约为1.49亿元至1.61亿元，环比较第二季度1.36亿元持续稳健增长。相关情况如下：

1、半导体材料业务及集成电路芯片设计和应用业务：实现营业收入约10.89亿元，同比增长88%，营收占比从2023年的32%持续提升至约45%水平。其中，第三季度：实现营业收入约4.49亿元，同比增长68%，环比增长33%；具体为：

①CMP抛光垫销售约5.24亿元，同比增长95%。其中，今年第三季度实现销售收入约2.26亿元，环比增长39%，同比增长90%；

②CMP抛光液、清洗液产品合计销售约1.38亿元，同比增长186%。其中，今年第三季度实现销售收入约6,155万元，环比增长53%，同比增长183%；

③半导体显示材料业务（YPI、PSPI、TFE-INK）合计销售约2.82亿元，同比增长162%。其中，今年第三季度实现销售收入约1.15亿元，环比增长18%，同比增长102%。

此外，公司半导体先进封装材料及晶圆光刻胶业务亦在快速推进中，多款产品在其客户端分别进入不同验证及市场开拓阶段，客户反馈良好，进展符合公司预期。

2、打印复印通用耗材业务：持续保持稳健经营，本期预计实现营业收入约 13.21 亿元，同比略有增长。公司将继续多举措进行降本增效，提升公司经营效率，多渠道拓展业务，夯实公司在行业的竞争力。

3、受汇率波动及上市公司实施股权激励成本影响，第三季度归属于上市公司股东的净利润影响额环比减少约 1,500 万元。

4、非经常性损益影响

预计本报告期非经常性损益约为 2,815 万元，主要是政府补助影响；去年同期非经常性损益金额为 4,680.91 万元。

四、风险提示及其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司披露的 2024 年三季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

环旭电子:2024 年 9 月营业收入简报

特别提示：本简报所载财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，最终数据以公司定期报告为准，请投资者注意投资风险。

环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 9 月合并营业收入为人民币 5,952,806,962.62 元，较去年同期的合并营业收入增加 4.19%，较 2024 年 8 月合并营业收入环比增加 12.68%。

公司 2024 年 1 月至 9 月合并营业收入为人民币 44,006,707,552.10 元，较去年同期的合并营业收入增加 2.21%。

公司 2024 年第三季度（2024 年 7 月至 9 月）合并营业收入为人民币 16,621,097,158.49 元，较去年同期的合并营业收入同比增加 2.65%，较第二季度（2024 年 4 月至 6 月）合并营业收入环比增加 19.63%。

北京君正:关于公司股东股份减持计划预披露公告

特别提示：

1、北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）持股 5%以上股东北京屹唐盛芯半导体产业投资中心（有限合伙）（以下简称“屹唐盛芯”）计划以集中竞价方式减持所持有的公司股份不超过 800,000 股，占公司总股本比例不超过 0.1661%；

2、本次减持计划拟通过集中竞价方式减持，自 2024 年 10 月 30 日至 2024 年 11 月 10 日实施该减持计划，符合首次卖出的 15 个交易日前预先披露减持计划的要求；

3、截至本公告披露日，屹唐盛芯持有公司股份 60,546,704 股，占本公司总股本比例 12.57%。

公司于近日收到屹唐盛芯关于减持计划的书面文件，现将相关情况公告如下：

一、股东的基本情况

股东名称：北京屹唐盛芯半导体产业投资中心（有限合伙）

持股数量（股）：60,546,704

占公司股本的比例（%）：12.57

二、本次减持计划的主要内容

- 1、减持原因：运营资金需求
- 2、股份来源：首发后非公开发行的股份
- 3、减持数量：不超过 800,000 股
- 4、减持比例：不超过 0.1661%
- 5、减持方式：集中竞价
- 6、减持期间：2024 年 10 月 30 日至 2024 年 11 月 10 日
- 7、减持价格区间：根据市场价格确定

8、屹唐盛芯所做承诺：上市公司对北京矽成半导体有限公司的重大资产重组事项中，屹唐盛芯作为业绩承诺方，承诺在本次购买资产项下取得的上市公司新增股份自发行完成之日起 12 个月内不得交易或转让，12 个月期满后，根据业绩承诺的完成情况分期及按比例解锁。

全志科技:2024 年前三季度业绩预告

一、本期业绩预计情况

1. 业绩预告期间:2024 年 1 月 1 日-2024 年 9 月 30 日
2. 预计的业绩:亏损扭亏为盈同向上升同向下降
3. 业绩预告情况表

(1) 2024 年前三季度（2024 年 1 月 1 日-9 月 30 日）业绩预计情况：

项目	2024年1月1日-2024年9月30日	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利：14,000万元-15,600万元	亏损：2,055.52万元
扣除非经常性损益后的净利润	盈利：10,000万元-11,800万元	亏损：4,220.94万元

(2) 2024 年第三季度（2024 年 7 月 1 日-9 月 30 日）业绩预计情况：

项目	2024年7月1日-2024年9月30日	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利：2,400万元-3,500万元	亏损：356.78万元
扣除非经常性损益后的净利润	盈利：2,000万元-2,800万元	亏损：612.17万元

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

1. 报告期内，公司把握下游市场需求回暖的机会，积极拓展各产品线业务，出货量提升使得营业收入同比增长约 50%，营业收入的增长带动了净利润的增长；
2. 报告期内，公司为满足客户持续增长的产品及服务需求，加大在芯片新产品开发及智能车载、扫地机器人等新兴应用领域方案的研发投入，研发费用同比增长约 10%；
3. 报告期内，预计公司非经常性损益对净利润的影响金额为 3,900 万元至 4,300 万元。

三安光电:关于获得政府补助的公告

一、获得政府补助的基本情况

1、2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 29 日，公司及下属子公司收到与收益相关、未履行信息披露义务且未达披露标准的政府补助款约 1,040.00 万元。具体情况如下表：

单位：人民币万元

序号	获得时间	收款单位	项目内容	补助依据	补助金额
1	2024/7/19	芜湖安瑞光电有限公司	税费返还	财税〔2011〕100号	160.15
2	2024/8/8	厦门市三安集成电路有限公司	其他各项费用补助	厦科资配〔2024〕23号	224.80
3	2024/9/18	泉州三安半导体科技有限公司	科技进步奖、优秀产品奖等各项奖励	闽政台〔2018〕72号	100.00
4	单笔100万元以下的政府补助小计				555.05
合计					1,040.00

2、公司 2024 年第三季度递延收益分期摊销转入其他收益的金额预计为 13,389.00 万元。

上述两项合计金额约 14,429.00 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的 39.36%。

7、风险提示

- (1) 半导体制裁加码
- (2) 晶圆厂扩产不及预期
- (3) 研发进展不及预期
- (4) 地缘政治不稳定
- (5) 推荐公司业绩不及预期

■ 电子通信组介绍

毛正：复旦大学材料学硕士，三年美国半导体上市公司工作经验，曾参与全球领先半导体厂商先进制程项目，五年商品证券投研经验，2018-2020 年就职于国元证券研究所担任电子行业分析师，内核组科技行业专家；2020-2021 年就职于新时代证券研究所担任电子行业首席分析师，iFind 2020 行业最具人气分析师，东方财富 2021 最佳分析师第二名；东方财富 2022 最佳新锐分析师；2021 年加入华鑫证券研究所担任电子行业首席分析师。

高永豪：复旦大学物理学博士，曾先后就职于华为技术有限公司，东方财富证券研究所，2023 年加入华鑫证券研究所。

吕卓阳：澳大利亚国立大学硕士，曾就职于方正证券，4 年投研经验。2023 年加入华鑫证券研究所，专注于半导体材料、半导体显示、碳化硅、汽车电子等领域研究。

何鹏程：悉尼大学金融硕士，中南大学软件工程学士，曾任职德邦证券研究所通信组，2023 年加入华鑫证券研究所。专注于消费电子、算力硬件等领域研究。

张璐：早稻田大学国际政治经济学学士，香港大学经济学硕士，2023 年加入华鑫证券研究所，研究方向为功率半导体、先进封装。

■ 证券分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

■ 证券投资评级说明

股票投资评级说明：

	投资建议	预测个股相对同期证券市场代表性指数涨幅
1	买入	> 20%
2	增持	10% — 20%
3	中性	-10% — 10%
4	卖出	< -10%

行业投资评级说明：

	投资建议	行业指数相对同期证券市场代表性指数涨幅
1	推荐	> 10%
2	中性	-10% — 10%
3	回避	< -10%

以报告日后的 12 个月内，预测个股或行业指数相对于相关证券市场主要指数的涨跌幅为标准。

相关证券市场代表性指数说明：A 股市场以沪深 300 指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以道琼斯指数为基准。

■ 免责声明

华鑫证券有限责任公司（以下简称“华鑫证券”）具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。本报告由华鑫证券制作，仅供华鑫证券的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告中的信息均来源于公开资料，华鑫证券研究部门及相关研究人员力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。我们已力求报告内容客观、公正，但报告中的信息与所表达的观点不构成所述证券买卖的出价或询价的依据，该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时结合各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就财务、法律、商业、税收等方面咨询专业顾问的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，华鑫证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。本公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等服务。本公司在知晓范围内依法合规地履行披露。

本报告中的资料、意见、预测均只反映报告初次发布时的判断，可能会随时调整。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。在不同时期，华鑫证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。华鑫证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。

本报告版权仅为华鑫证券所有，未经华鑫证券书面授权，任何机构和个人不得以任何形式刊载、翻版、复制、发布、转发或引用本报告的任何部分。若华鑫证券以外的机构向其客户发放本报告，则由该机构独自为此发送行为负责，华鑫证券对此等行为不承担任何责任。本报告同时不构成华鑫证券向发送本报告的机构之客户提供的投资建议。如未经华鑫证券授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。华鑫证券将保留随时追究其法律责任的权利。请投资者慎重使用未经授权刊载或者转发的华鑫证券研究报告。